



Our preparations *for*
GROWTH
are **NOW**
producing **GROWTH**

Why?

ACCRETECH
ACCRETECH
ACCRETECH

アニュアル レポート 2006

株式会社 東京精密

「WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」

このモットーは、東京精密に常に革新と成長をもたらしてきました。当社の製品は、半導体製造工程における製造・検査装置から自動車や工作機械向け計測機器に至るまで、他社の追随を許さない独自の技術と製品コンセプトを有しています。

当社は「製品開発の原則」(18ページ掲載)を経営の大原則として、チャレンジ精神旺盛な社風の中で創造性と高い目標を追求しています。今、まさにその目標達成に向けた取り組みの一つひとつが開花し始めています。新しい市場向けに投入した半導体製造装置事業の新規参入製品群は売上に占める割合を年々拡大し、既存製品群は新技術の搭載と改良によって独自の強さを発揮し、市場での確かな地位を築いています。その結果、当社の製品群はさらに力を増し、収益構造は一層強固なものとなっています。

THE COMPANY

東京精密のコーポレートブランドである「ACCRETECH(アクレーテク)」(accrete「共に成長する」+technology「技術」)には、最先端技術を融合し、ニーズの高い世界No.1の商品を創り、お客様が直面している困難な問題を解決することで、企業として持続的に成長していきたい、という当社の強い思いが込められています。

目次

フィナンシャルハイライト	01
株主の皆様へ	02
社長インタビュー	03
特別顧問からのメッセージ	07
営業概況	08
半導体製造装置事業	08
計測機器事業	14
研究開発活動と知的財産	18
コーポレートガバナンス	20
環境への取り組み	22
役員紹介	23
フィナンシャルセクション	24
ネットワーク	48
インベスターインフォメーション	49

見直しに関する注意事項

このアニュアルレポートに掲載されている東京精密の現在の計画、見直し、戦略、その他の歴史的事実ではない事柄は、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。リスクや不確実性には、経済の動向、当社の事業領域の市況、為替変動、急速な技術革新による競争の激化などがあります。このような事象により、実際の業績はこれら見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

フィナンシャルハイライト

株式会社東京精密及び連結子会社
2005年及び2006年3月31日に終了した年度

	百万円		千米ドル	増減(%)
	2005	2006	2006	
会計年度:				
売上高	¥ 84,750	¥ 92,845	\$790,373	9.6%
半導体製造装置	66,669	71,824	611,432	7.7
計測機器	18,081	21,020	178,941	16.3
営業利益	13,051	13,991	119,109	7.2
税金等調整前当期純利益	6,401	7,865	66,959	22.9
当期純利益	4,459	3,125	26,606	(29.9)
設備投資	3,771	3,978	33,867	5.5
減価償却費	2,732	2,768	23,567	1.3
研究開発費	6,300	7,919	67,421	25.7
半導体製造装置	5,755	7,296	62,114	26.8
計測機器	545	623	5,306	14.3
会計年度末:				
総資産	¥100,993	¥109,875	\$935,350	8.8%
株主資本	33,003	46,703	397,576	41.5
		円	米ドル	増減(%)
1株当たり:				
当期純利益－希薄化前	¥ 118.82	¥ 80.77	\$ 0.68	(32.0)%
年間配当額	30.00	40.00	0.34	33.3

注:米ドル金額は2006年3月31日における換算レート、すなわち1米ドル117円47銭で便宜上換算している。

**中期経営計画「AA60」の実行によって、
新規参入製品群と既存製品群の成長を
加速させ、さらに業績を向上させていき
ます。**



この2006年3月期も当社は、革新的技術を搭載した製品群によって継続的な成長を実現しました。売上高は2期連続で過去最高を更新し、収益も堅調でした。当社の経営の大原則である「製品開発の原則」に沿った経営が、この成長に結びついていることを証明しています。

ここ数年、当社では「製品開発の原則」に従って、業績に左右されることなく高レベルの研究開発投資を継続してきました。この研究開発が数々の有望な製品を生み出し、新市場へ進出することが可能となりました。2006年3月期はこれらの新規参入製品群が、かつてないほど当社の成長に貢献しました。厳しい時期にも製品開発に注力してきたことが、半導体製造装置および検査装置の新分野における各製品の開花につながっています。計測機器事業においても「製品開発の原則」が売上拡大のカギとなり、収益を力強く牽引しています。

また、2006年3月期は将来を見据える良い年にもなりました。当社では当期、2009年3月期までの中期経営計画「AA (ACCRETECH Action) 60」(4ページ参照)を策定し、具体的目標と実践計画を設定しました。私は、当社での40年の業務経験の中で半導体製造装置と計測機器の両事業部門に携わり、当社の強みや課題を十分に認識していると考えていました。しかし、「AA60」を策定する過程はこれらの強みを再認識、いかに活用すべきかを改めて熟考する機会となり、当社の今後の成長を今まで以上に強く確信しています。

東京精密は、常に将来のビジネス展望や戦略を明確に打ち出してきました。それは、お客様との信頼関係を築くこと、当社の企業価値を高めることによって、株主の皆様へに資することにつながってきました。当社だからこそポリッシュ・グライнда(11ページ参照)のような独創性の

高い装置を創ることができたのです。当社だからこそ「世界No.1製品を創る」という目標に向かってこれほど真摯に取り組むことができたのです。そして私たちは今世界No.1の製品を実際に開発し、ニーズに応えることで、着実に企業としての成長ステージを高めています。

私は、創造性を高く評価されているこの組織を率いていることを誇りに思っています。今後とも高い革新性と新分野に果敢に取り組んでいく企業文化をさらに醸成し、当社を次なる発展のステージに導いていきます。

鈴木貞勝

代表取締役社長CEO兼COO
鈴木 貞勝

社長インタビュー



What's

Ahead for Tokyo Seimitsu After a Strong Performance?

業績好調の東京精密の今後の方向性は？

Q1. 2006年3月期の東京精密の好業績であった要因を教えてください。

当期、当社の業績は全般的に極めて好調でした。半導体製造装置事業および計測機器事業はどちらも当初の計画を上回り、2期連続で受注高と売上高の過去最高を更新しました。

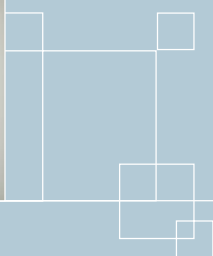
半導体製造装置事業において、とりわけ注目していただきたい点は、既存製品群(ウェーハプロービングマシン、ウェーハダイシングマシンなど)および新規参入製品群(ウェーハ外観検査装置、ポリッシュ・グラインダ、CMP)の両方で好業績をあげることができたという点です。特に、成長性の高い領域にターゲットを絞った新規参入製品群の伸びは、当社が半導体製造装置産業の平均成長率以上の成長を遂げる原動力となりました。新規参入製品群の当期の売上高は20%増加しました。この成長を牽引したのは、2000年に販売を開始したポリッシュ・グラインダです。この製品はその優れた製品コンセプトと技術力で新市場を切り拓いた市場創造型製品であり、圧倒的なシェアを確保しています。同時に、既存製品群も成長に寄与しています。当社はウェーハプロービングマシンを40年以上にわたって製造・販売しており、この成長性の高い市場で当社は、世界トップシェアを誇っています。当社はこの製品で、当期、2001年3月期のピークを上回る過去最高の売上高を達成することができました。このように、この1年は既存製品群の強さを改めて示すとともに、新規参入製品群においても大きな進展を見せた年となりました。

計測機器事業においては、4年連続して増収増益を達成しました。さらに、受注高、売上高、営業利益のすべてが3年連続で既往ピークを更新しています。日本では自動車産業および工作機械産業での設備投資が活況を呈しており、当社はその強い需要を的確に捉えることにより、好業績をあげることができました。私たちは、効率的で、精密かつ高い信頼性を要求される分野を対象とした製品群によって、こうした需要に応える体制を築いてきました。2005年に完成した新工場も、当期の大幅な業績の向上に大きな役割を果たしています。

財務体質の改善と収益基盤の強化の観点から、2006年3月期において特別損失6,281百万円を計上したことにより、当期純利益は減少しました。損失の主な内訳は、半導体製造装置の旧機種のため卸評価損及び廃却損、そしてLEEPL(リープル:低加速電圧電子ビーム近接投影露光技術)装置関連設備の固定資産除去損およびリース解約費用などです。今回の会計処理が完了することにより、健全な財務基盤で将来の目標達成を目指すことができるようになります。

Q2. 2007年3月期も引き続き業績は伸長するのでしょうか？

2007年3月期は、半導体製造装置事業および計測機器事業のどちらも好調さを維持し、連結売上高は1,020億円と、初めて1,000億円の大台を超えると予想しています。パソコン、携帯電話、デジタル・コンシューマー機器、自動車関連などの伸



長により、半導体は引き続き高い需要が見込まれています。さらに、自動車産業および工作機械産業での活発な設備投資も期待されているため、計測機器についても良好な市況が見込まれます。今後も良好な経営環境の継続が見込まれていることから、当社では、半導体製造装置事業および計測機器事業の双方で業界の伸びを上回る成長が実現でき、3期連続で売上高は既往ピークを更新すると考えています。なお、日本国内の半導体関連の設備投資需要が活況なため、半導体製造装置事業の売上に占める輸出比率は若干の減少が見込まれています。

一方、当社では2006年4月より、新規参入製品群であるウェーハ外観検査装置、ポリッシュ・グラインダ、CMPの売上に対する会計上の収益認識基準を、従来の出荷基準から設置完了基準に変更しました。これは、既存製品に比べ出荷から設置完了までの期間が長い新規参入製品群の売上構成比が高くなってきたことから、収益の実態をより適切に業績に反映させることを目的としたものです。この会計基準の変更による

2007年3月期の売上高への影響は、約20億円の減少と予測され、新規参入製品群は引き続き売上高を拡大させるものの、その伸び率は当該期において一時的に低下する見込みです。

Q3. 2006年4月からスタートした中期経営計画「AA60」とはどのような計画ですか？

「AA60」は、各製品グループと徹底的に議論し、具体的な数値を積み上げて策定した計画です。「AA60」の「AA」は「ACCRETECH Action」を、「60」は計画の最終年である2009年3月期に当社が迎える創立60周年(2009年3月28日)をそれぞれ表しています。

計画では最終年度の売上目標を、半導体製造装置事業で1,000億円、計測機器事業で250億円、合計で1,250億円としています。また、2006年3月期には15.1%であった営業利益率を25%まで引き上げる計画です。これらの目標は、計画が予定通り実行されれば十分に実現可能な範囲です。「AA60」の最終年度には北京オリンピックが開催され、半導体市況はこの時期、非常に好況になると考えられています。さらに、国内自動車メーカーを中心に、今後数年にわたり積極的な設備投資を継続するとの見通しが発表されており、計測機器事業についても良好な事業環境が期待できます。

計画達成のカギは、新規参入製品群の成長および既存製品群における新製品の投入にあります。当社の新規参入製品群は、経営の大原則である「製品開発の原則」に従い、最先端の製

中期経営計画「AA60」(ACCRETECH ACTION 60)	
売上高:	1,250億円
半導体製造装置	1,000億円
計測機器	250億円
営業利益率:	25%
計画最終年度:	2009年3月期 (創立60周年)



インタビュー：

代表取締役社長 CEO兼COO 鈴木 貞勝

Interview: Sadakatsu Suzuki

品開発による業容拡大と高収益なビジネス基盤の構築を目指して開発されてきました。これらの新規参入製品群は基準とする年間販売台数に到達すると、高収益が実現できます。一方、既存製品群は、高性能化による拡販と徹底したコスト削減により売上拡大と収益性の向上が見込まれています。また、新規参入製品群におけるコスト削減や販売管理費の削減も推進しています。特別損失などの財務上の諸施策もすでに完了したことにより、さらに機動的な経営体制となりました。

Q4. 東京精密を経営していくうえでの最終的な目標を教えてください。

私にとっての最終的なゴールは、継続的な成長が可能な基盤の構築にあります。そして、こうした成長を実現していくのが、成長性が高い市場を狙った技術とチャレンジ精神旺盛な社風だと考えています。中期経営計画「AA60」を成功させることが、この目標達成への大きな一歩となるはずです。

私はCEOに就任して以来、「この会社をさらに発展する企業とするにはどのように経営すべきか」を常に考えてきました。各製品部門の社員とこの主題についての対話も重ねました。「AA60」は、こうした過程で得たすべてを盛り込んで策定したものです。そしてこれは私にとって、改めて東京精密という会社を見直すという貴重な機会となりました。

計画策定作業を通し、当社の強みに対する私の自信は一層強固なものとなりました。当社の最大の強みはやはり「製品

開発の原則」に則った新製品の開発力です。これまでに数々の新規参入製品を開発してきましたが、その中でポリッシュ・グラインダのように市場創造型の装置の開発を行うことが投資効率の点から最も有効と考えており、今後の新規参入製品は、市場を創造できる装置の開発に焦点を当てていく方針です。従来存在しない市場であれば、競合が存在せず、投資額を抑えてリスクを低減しながら比較的早い段階でファクト・スタンダードの地位が獲得できます。その結果、マーケット・リーダーとして、高シェアの確保と高収益の実現が可能となります。

市場創造型製品の開発は簡単なことではありません。しかし、あえて難度の高いレベルを設定し、それに果敢に挑戦していくのが当社の一貫した姿勢です。難しい領域に踏み込んでいけるのは、それだけの技術の蓄積や開発にかかる会社としての真摯な姿勢、絶えず挑戦していく企業風土があるからであり、これらが当社の競争力を一層高めていると考えています。

また、社員が問題発見とその解決に高い能力を備えていること、その結果、事業遂行のスピードが早いことも強みとして挙げられます。当社には一人で作れる製品はありませんので、組織内ではチームワークが非常に重視されています。チームのメンバーは国籍や年齢などを問わず、緊密なコミュニケーションを行い、最高のチームワークを実現しています。

同様に重視しているのは、お客様とのコミュニケーションです。当社では、開発に当たるエンジニアは国内外どこでもお客様のものを頻りに訪問しています。お客様との対話の中で



ニーズやシーズを肌で感じながら実際の開発や設計に活かすという機動性の高さが、魅力ある製品のスピーディな開発につながっています。さらに、開発スピードを向上させ、開発コストをシェアするために、「Win-Win」の関係に基づいた多様なアライアンス提携を行っていることも大きな強みとなっています。

Q5. 株主価値の最大化のためにはどのようなことが必要とお考えですか？

当社では、一株当たり当期純利益(EPS)を重視しており、EPSの増大が株主価値の最大化につながると考えています。中期経営計画「AA60」が終了する2009年3月期のEPSは約470円と予測しています。

配当も株主価値の向上で重視している点の一つであり、当社は連結当期利益の20%の配当を行うことを方針として、2006年3月期は1株当たり40円へ増配を実施、2007年3月期にはさらに50円へ増配を予定しています。継続的な事業規模の拡大と安定した配当の継続で、株主の皆様への還元をより充実させていきます。

当社の株主の皆様のご多くは、当社の長期的な成長を期待して株式を保有していただいていると思います。したがって、その期待に応えるためには、積極的な製品開発が不可欠です。当社は業績に関わらず、研究開発費を継続して投入しています。ウェーハ外観検査装置、ポリッシュ・グラインダ、CMP装置な

どは、こうしたたゆまぬ開発努力の成果であり、それぞれがターゲットとした市場で高いシェアを獲得しています。製品開発は、成長の原動力として今後一層の寄与が期待されます。今後も将来を見据えた開発によって、常に世界No.1のシェアを獲得できる製品を目指して、非常に積極的な姿勢で研究開発を進めています。株主の皆様へ、当社が何を目指し、それをどのように実現してきたか、あるいは実現しようとしているかをきちんと理解していただくこと、積極的な研究開発が業績への寄与につながることを証明していくことが、私の最大の使命だと考えています。

MESSAGE FROM PRINCIPAL ADVISER

HIDEO OHTSUBO

特別顧問からのメッセージ

新たな時代に向けて

東京精密での18年

私は2005年12月に東京精密の会長職を辞しました。1988年の入社以来、東京精密の経営に携わってきましたが、この18年間で当社は大きな変貌を遂げました。

1988年当時の当社は、半導体産業につきもののシリコンサイクルの影響から逃れられず、事業環境の変動によって業績が大きく上下していました。その中で生き残るには、世界一の技術を用いた世界一の製品を持つ企業になる必要があると痛切に感じました。不況時においても、トップメーカーの製品なら必ず売れるからです。2位以下では意味がありません。当社がNo.1にこだわる原点はここにあります。

世界No.1製品を実現

東京精密の変貌の第一歩は、強い製品を開発するための方向性を「製品開発の原則」として明文化したことです。この原則は今でも変わることはありません。組織面では、技術者をヘッドとするグループリーダー制を取り入れ、2002年にはカンパニー制を導入し、部門ごとの完結性を追求しました。

世界No.1の製品で世界No.1の企業を目指すための次なる変貌は、2001年に新たなコーポレートブランドとして「ACCURETECH(アクレーテック)」を導入したことです。これは、“accrete”(共に成長する)と“technology”(技術)の合成語で、優れた人材が当社に集い、世界最高水準のさまざまな技術を結集させて「世界No.1の製品を創る」ことを意味しています。その実現のために、業績にかかわらず一貫して研究開発費を確保し、高い技術力を反映した数々の製品を市場に投



入してきました。こうして地道に継続した努力により生み出されたのが、当社の技術の高さを示す半導体製造装置事業の新規参入製品群です。その成果は、2006年3月期よりしっかりと形になってきています。

東京精密の新経営陣は、経験豊かな役員で構成されています。当社で、世界No.1になるという目標を追求するために必要とされた組織や文化の変革に取り組んできた年月を共有し、全員が当社の脈々としたチャレンジ精神を受け継いでいます。私は、新経営陣に全幅の信頼を置いており、今後も東京精密らしく技術の集約を通した、ACCURETECHなスタイルでの成長を実現してくれるものと確信しています。

2006年6月

大坪英夫

特別顧問
大坪 英夫

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING EQUIPMENT

半導体製造装置事業



工学博士
長澤 英二
代表取締役EVP
半導体社社長

2006年3月期を振り返って

半導体生産量は、2005年3月期に高い成長率を記録したため、2006年3月期は横ばいまたはマイナス成長が予測されていました。しかし実際には、液晶テレビやプラズマテレビといった薄型テレビ、携帯音楽プレーヤーなどのデジタル家電製品の需要増や、パソコン・携帯電話の好調などにより、生産量は引き続き増加しました。半導体業界の動きとの相関性の高い半導体製造装置業界も、こうした市場動向を反映し、2005年3月期は投資額50%と大幅に伸びたものの、2006年3月期は緩やかな成長にとどまりました。

その中で、当社の半導体製造装置事業は、期の初めに小さな調整があったものの、ニーズに応えるきめ細かい営業を展開した結果、当期の受注高は前期比19.4%増の778億74百万円、売上高は

前期比7.7%増の718億24百万円と、4期連続の増収で2期連続で過去最高の売上高を更新しました。さらに、新規参入製品群は当期も順調に売上規模を拡大し、半導体製造装置事業の売上高に占める割合は、2005年3月期の26%から2006年3月期には29%まで上昇しました。

利益面では、売上増による利益の拡大に加え、固定費削減、内製比率アップにより変動比率が引き下げられたことなどによるコストダウンが功を奏しました。一方で、価格競争による圧力や製品開発コストなどがあったため、営業利益は前期比伸長したものの、売上高の伸び率には及ばず、前期比2.1%増の89億72百万円となりました。

ウェーハプロービングマシン(プローバ)

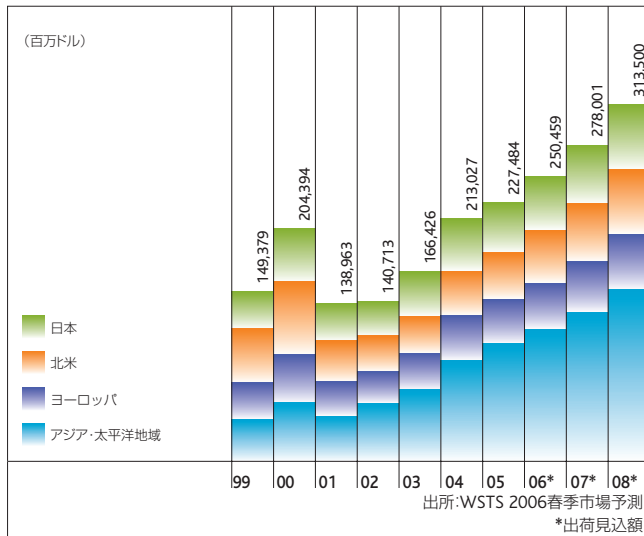
当初、当期は半導体メーカーの設備投資意欲が低下し、プローバの売上高も前

期を下回ると予想されていました。しかし実際には、DRAMやNANDフラッシュ、LCDドライバを中心とし、全般的にデバイス需要が好調であったことと、ウェーハレベルでのフルテストの必要性などが高まったことを背景に、市況は極めて活況となりました。300mmウェーハ対応プローバ「UF3000」に対する需要が大きく伸びたため、当社は200mm用に加え300mm用プローバでもトップシェアを獲得し、世界No.1のプローバメーカーとしての地位をゆるぎないものにしました。

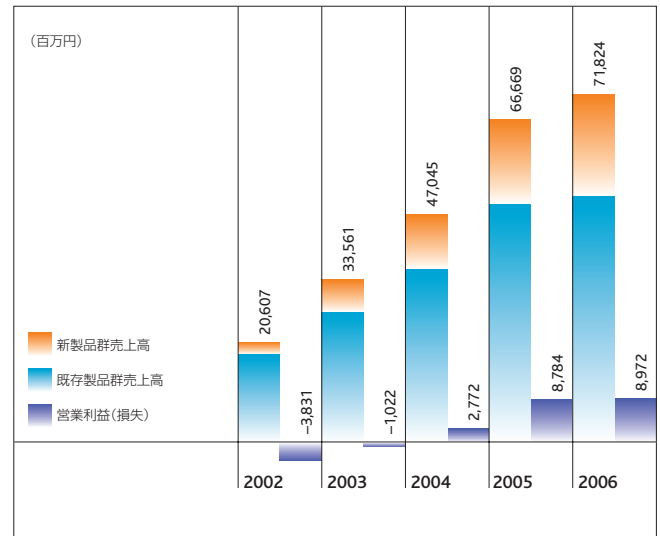
「UF3000」は300mm対応の第三代機で、システムLSIなどから、メモリまであらゆるデバイスに対応しています。当期の同製品に対する需要増は、超高性能プローバとして、お客様から高い支持を得られた証左だと考えています。当社のプローバは、VLSIリサーチ社の顧客満

半導体生産高

(12月31日に終了した暦年)

半導体製造装置事業
売上高/営業利益(損失)

(3月31日に終了した事業年度)



足度調査のハンドリング部門において11年連続で「10BEST賞」を受賞しており、当期は第3位で、プローバメーカーの中では最上位にランクされました。当社ではまた、台湾を中心に依然として堅調に推移する200mmウェーハに対するニーズにも応えています。2005年には±1.5μmの高精度、高剛性、高スループットのウェーハプローバ「UF2000」を新製品として投入しました。

半導体業界のさまざまなトレンドからは、今後もプローバに対する需要はますます高まると予測されます。その要因としては、半導体の微細化・高機能化が進み、テスト項目がより増加すること、高集積化によりテスト時間が長くなることなどがあげられます。また、より早い段階で良品・不良品の判別をすることによって半導体生産の効率化を図るために、半導体組み立て後の完成段階でファイナルテ

ストで実施していたフルテストをウェーハ段階でも実施するという傾向が強まっています。こうした動きが需要を押し上げているため、プローバの市場は半導体製造装置業界全体の成長率をさらに上回る勢いで成長しています。その結果、2006年3月期、当社はウェーハプローバのNo.1プレーヤーとして世界シェアをさらに拡大し、2001年3月期のピークを上回る過去最高の売上高を達成しました。

2007年3月期については、恵まれた市場環境の中でマーケットシェアをさらに伸ばし、受注高・売上高ともに前期を大きく上回ると予想しています。デバイス別では、メモリやLCDドライバが引き続き好調であることに加え、LSIロジック系デバイス向けの需要が見込まれています。また、利益率の向上を目的として取り組んでいる内製化の促進や生産方式の革

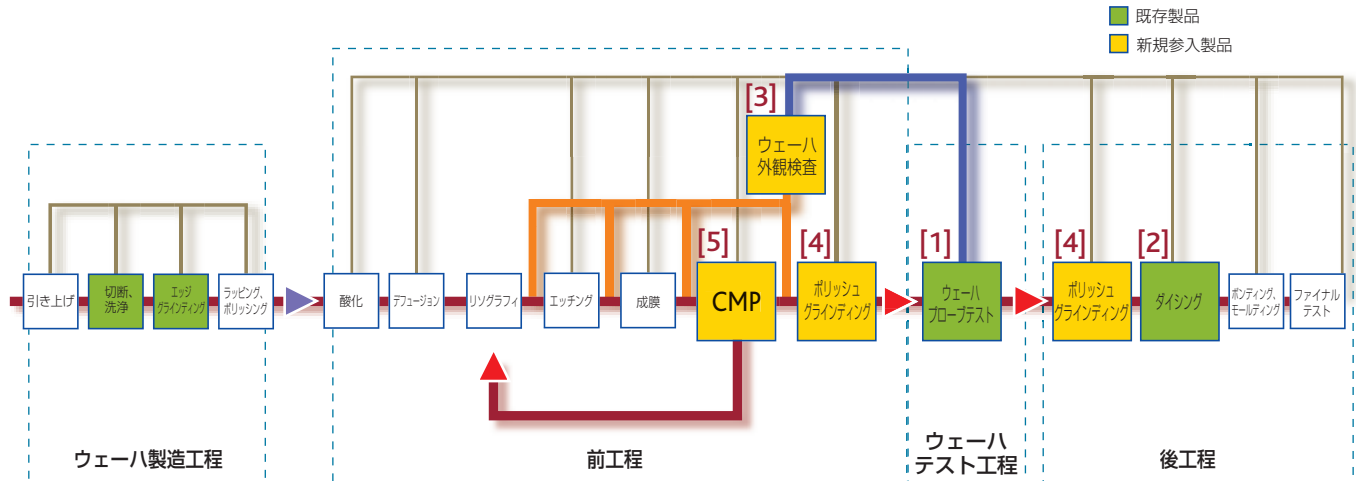
新の成果もあがりはじめ、収益性のさらなる向上に寄与すると考えています。

ウェーハダイシングマシン(ダイサ)

ダイサの業績回復の遅れにはいくつかの要因があります。ダイサの市場回復はプローバより数ヶ月遅れており、2006年3月期の下期後半から売上が向上してきました。また、新製品開発の谷間の時期となったことも要因として挙げられます。プラス面では、レーザーダイサ「MAHOHDICING MACHINE」が、その卓越した性能が認識されるに従い、受注高および売上高が急速に伸びたこと、当社が顧客満足度調査のアセンブリ部門において5年連続で「10BEST賞」を受賞、5回目の当期は3度目の第1位を獲得したことが挙げられます。

当社は2005年末に300mmウェーハ用ブレードダイサの新機種として毎

半導体製造工程



分8万回転のスピンドルを備え、高い生産性を有する「A-WD-300TX」を発表しました。この機種は高品質な切断と高スループットによる生産性の向上などが特徴で、2006年4月から販売を開始しました。

浜松ホトニクス株式会社と共同開発し、2005年3月期に販売を開始した新型レーザーダイサ「MAHOHDICING MACHINE」は、2006年3月期に売上を倍増させ、ほぼ計画通りの受注高・売上高を達成しました。このレーザーダイサの大きな特長は、ブレードを使わず完全にレーザーのみでウエーハを個片化することです。このため、非常に薄いウエーハでも割れや欠けがなく、かつ従来のダイサの4倍のスピードで個片化することが可能です。また、従来のブレードダイサでは不可避であった静電気防止のための切削水が不要であること、また個片化時に切子が出

ないため洗浄も不要であることから全く水を使わないで処理できることも大きな強みです。さらに、ブレードダイサで発生する切り代のロスもなくなり、1枚のウエーハから生産できるチップ数が増加します。つまり、当社のレーザーダイサは、ブレードダイサとも他のレーザーダイサと言われる装置とも全く異なる技術やシステムを用いた画期的な製品なのです。これらの特長からレーザーダイサは、製造過程において水を嫌うMEMS（マイクロマシン）や、切子などのゴミを嫌うC-MOSおよびCCDイメージセンサなどのデバイス向けの市場へ出荷されています。

2007年3月期のダイサの見通しについては、過去最高と同水準の売上高が見込まれています。要因としては、高性能なブレードダイサの新製品「A-WD-300TX」がすでに市場から好評を得ており、ます

ますの拡販が期待されていること、また、レーザーダイサ「MAHOHDICING MACHINE」のリピートオーダーの増加のほか、薄物ウエーハやディスクリートLED向けなど、アプリケーションと新規ユーザーの拡大が確実なことなどがあげられます。

ウエーハ外観検査装置

2006年3月期のウエーハ外観検査装置の売上高は、堅調に推移しました。特に当期は、国内の半導体メーカーから多くの受注を得たこと、アジア地域のメーカーから新規受注を獲得したことが高く評価できると考えています。装置評価に長期間を要するウエーハ外観検査装置のような装置では、一流メーカーからの高い評価は市場への浸透を加速させるため、高評価の獲得は、販売数量の拡大とともに重要なポイントとなっています。

[1] ブローバ [UF3000]



ブローバは、ウェーハ上に形成された半導体チップの電気性能テストを行う装置であり、半導体品質管理において欠かせない装置です。

[2-A] ダイサ [A-WD-300TX]



ダイサ(ブレードダイサ)は、ウェーハ上に形成された多数の半導体チップをブレード(刃)を用いて一つひとつのチップに切断する装置です。

また、「WIN-WIN 50」シリーズの新機種「WIN-WIN 50モデル1600」を発表しました。検査装置で重要とされる致命的な欠陥を検出できる感度と、生産効率向上のためのスループットを高めた、65nmデザインノードデバイスの量産ライン向けの機種です。当社の「WIN-WIN 50」シリーズには、ビジネスパートナーであるカール ツァイス社と共同開発した独自の共焦点顕微鏡を搭載しており、解像度が高く、高品質な画像が取得できるという特長が、最近の微細化の進展でより小さい欠陥を検出したいというユーザーニーズにマッチしています。

2007年3月期においては、「WIN-WIN 50モデル1600」を加えた充実のラインナップによる売上拡大を見込んでいます。90nm以降のデザインノードのデバイス向けの高感度外観検査装置に対する需要の増加が見込まれています。同

時に、高密度化が進み、リソグラフィー後の工程での欠陥検出の重要性が高まる市場環境においては、当社装置の強みが活かされ、さらなる売上高の拡大が期待されます。

また、主に研究開発用途として、当社は株式会社日立ハイテクノロジーズと共同で開発した「HA-3000」を提供しています。「HA-3000」は、高感度での検査に特化しており、研究開発部門での使用に最適となっています。この「HA-3000」と「WIN-WIN」シリーズとを併用することで、オールマイティーな検査領域をカバーすることができます。デザインノードや回路の高密度化の進展で、致命的な欠陥の検出に対する需要はさらに高まっており、当社は、こうしたお客様のニーズに十分に対応できる体制を整えています。

ポリッシュ・グラインダ

当社のポリッシュ・グラインダは、ウェーハの薄片化とダメージ除去を1台で実現できる当社独自のコンセプトで開発された製品です。ウェーハ薄片化装置市場では圧倒的シェアを獲得し、デファクトスタンダードとなっています。近年、携帯電話などの最終製品の小型・高性能化にともない、搭載されるデバイスを薄くし、積層させることで集積度を高める傾向にあります。しかし、ウェーハは薄くなればなるほど、搬送による割れや欠けなどのダメージを受けやすくなります。1台の装置内で搬送リスクを負うことなく薄片化とダメージ除去が可能な当社のポリッシュ・グラインダは、こうした問題を解決できる装置です。当社のベストセラー機は、4つの工程を1台の装置で実現する「PG300RM」であり、周辺の工程を次々に取り込んでいくこの装置は、近

[2-B] レーザーダイサ [MAHOHDICING MACHINE]



レーザーダイサは、ブレード(刃)を使用せず、レーザーを用いてウェーハを高速切断します。水を使用せず、完全ドライプロセスを実現します。

[3] ウェーハ外観検査装置 [WIN-WIN 50モデル1600]



ウェーハ外観検査装置は、回路のパターンが転写されたウェーハ表面の異物やパターン欠陥などを検出する装置で、半導体の歩留まり向上に貢献します。

年の薄片化の流れを牽引する市場創出型製品といえます。また、当社のポリッシュ・グライндаは、近年急速に進化するスタックダイ、PoP (Package on Package)、PiP (Package in a Package)などの三次元実装技術における要求に十分にに応えられる装置です。これらの実装技術は携帯電話、デジタルカメラ、携帯用音楽プレーヤーなどの携帯用最終製品の製造には不可欠な技術となっています。

ポリッシュ・グライндаの2006年3月期の売上高は、前期に続き大幅に伸長しました。大幅増の要因は、従来の売上の中心であった韓国に加え、中国や台湾などの地域で売上が増加したことにあります。これは、主用途であるNANDフラッシュの生産が拡大し、その組立がより多くの国で行われるようになったためです。こうした市場環境を反映して、当期

は300mm対応機である「PG300」シリーズの需要が急拡大し、受注高・売上高とも前期を大幅に上回り、当社の中核製品のひとつに成長しました。

2006年3月期下期に一部の地域で若干の減速がありましたが、2006年の夏からは回復すると見込んでいます。また、他の地域での売上増が見込まれることから、2007年3月期のポリッシュ・グライндаの売上高は、大幅に伸びた2006年3月期の売上規模をさらに上回ると予想されています。

CMP

当社のCMPは、大手デバイスメーカーの300mm銅配線用量産ラインにおいて、高性能・極めて高い稼働率・安定性を高く評価されています。当社製品は、独自のエアフロートヘッドの採用により、他社の追従を許さない低圧高速研磨をはじ

めとした数々の高機能を実現するとともに、高い稼働率で生産性の向上に貢献しています。

CMPは、半導体の製造工程の高機能化・高集積化に大きな役割を果たす装置であり、主に前工程の誘電体層あるいは金属層の平坦化を目的として用いられています。そのため、近年高まりをみせる多層配線のロジックデバイスの生産量増加や半導体デバイスの高機能化・多層化の進展は、CMP市場にとっては追い風となります。特に重要なのは、当社のCMPは、難易度が最も高い銅配線プロセスに対しても高均一な平坦化が可能であるため、銅の多層配線をともなう半導体デバイスの生産量が拡大していることは、当社の装置の需要の増加につながっているといえます。

2006年3月期には、CMPビジネスの基盤確立を最優先に取り組み、装置性能

[4] ポリッシュ・グラインダ [PG300RM]



ポリッシュ・グラインダは、ウェーハの裏面を研削すると同時に、ダメージ除去を行います。これらの基本機能に加えて、周辺プロセスに対応したさまざまなアプリケーションを提供しています。

[5] CMP装置 [ChaMP-332M]



CMP装置は、ウェーハ表面の凹凸を平坦化する装置で、半導体デバイスの多層化や、配線材料の多様化にともない、用途が拡大しています。

のさらなる向上と大手メーカーでの装置評価に注力しました。この取り組みは、順調に成果をあげており、今後のビジネス拡大に十分な手ごたえを感じています。これにより、2007年3月期からの本格展開に向けた準備は整ったと考えています。2006年4月に市場投入した新モデル「ChaMP-332M」で、さらなる販路拡大を見込んでいます。CMPビジネスでは、2007年3月期下期での黒字化を目指しています。

中期経営計画「AA60」の達成に向けて

中期経営計画「AA60」では、半導体製造装置事業として2009年3月期には売上高1,000億円以上、営業利益率25%以上とすることを目標としています。これを達成するために、当事業ではいくつかの戦略を策定しています。

製品開発においては2つの戦略があり

ます。まず、当社が既に参入しているすべての製品分野においては、圧倒的差異化製品を開発し、市場シェアの継続的拡大を図ることを目指します。次に、今後の新規参入に際しては、市場創造型の製品開発に注力し、マーケットリーダーとなることを目指します。上述の製品開発全般において、半導体の微細化と、テストおよびパッケージング工程での高付加価値化という二つの大きな技術の流れに対応していきます。

また、生産体制においても大きく2つの方面での施策を進めていきます。一つは、生産革新活動による生産性向上とコスト削減を強力に推進し、高収益化を図ること、そしてもう一つは、さらなる業容拡大や生産性向上のために設備投資を積極的に推進することです。生産は、メーカーの競争力の源泉であり、これらの施策の実行により、景気の下降局面でも利

益を確保できる生産方式を確立させたいと考えています。

当社が目標としているのは、既存製品群と新規参入製品群の双方において成長を実現することです。既存製品群では、コスト削減を継続する一方でシェアのさらなる拡大を図り、収益性を高めていくことが目標となります。一方で、新規参入製品群における最優先課題は、市場でNo.1の地位を獲得し、ビジネス規模の拡大によって利益を得ることです。新規参入製品においても、既存製品群と同様に、継続してコストの削減を図っていきます。

MEASURING SYSTEMS

計測機器事業



藤森 一雄
代表取締役EVP
計測社社長

2006年3月期を振り返って

計測機器業界は、当期も自動車関連産業や工作機械産業の活況を反映し、全般的に好況でした。その要因としては、自動車業界において、さらなる品質向上のために高精度の部品の使用が増加していること、また、世界的な自動車の年間生産台数の増加で生産ラインが増設されていること、加えて、車体計測の需要も高まっていることなどがあります。

その中で、当社の計測機器事業の2006年3月期の受注高は前期比19.1%増の216億83百万円、売上高は前期比16.3%増の210億20百万円となり、ともに過去最高を記録しました。利益面では、内製化への移行など生産面でのコストダウンにも継続して注力した結果、

営業利益は前期比17.6%増の50億19百万円となりました。4期連続の増収増益と3期連続で過去最高の受注高・売上高・営業利益を達成した当期の成長で大きな役割を果たしたのが、土浦にある計測社の新工場です。2005年に完成した同工場の稼働は、国内の製造業での設備投資需要の高まりに応えるためには最高のタイミングでした。

下期からは、薄型テレビなどの家電メーカーや半導体の製造装置関連など、自動車以外の業界で設備投資が活発化し、製造業全体で需要が高まってきました。牽引役となったのは依然として自動車産業でしたが、それ以外にも工作機械やベアリング、電機、半導体製造装置、精密機械などの業界からの受注も拡大

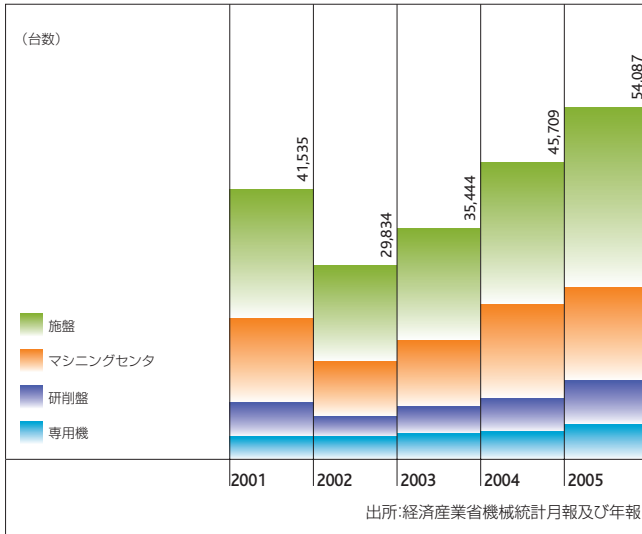
しており、さらにそれぞれの規模が大きくなることによって、業界固有の景気変動の波による影響が軽減できる構造が構築されつつあります。

汎用計測器事業

汎用計測器事業では、自動車業界の活況を主な要因として、三次元座標測定機を中心に大きく伸長しました。三次元座標測定機が伸長した要因は、自動車関連業界において、さまざまな部品を生産できる柔軟性の高い生産ライン構築のための計測機器が求められていることです。自動車部品の生産ラインにおいて、品質管理のために従来から使用されているゲージは依然として欠かせない存在ですが、ゲージは生産製品ごとに設計

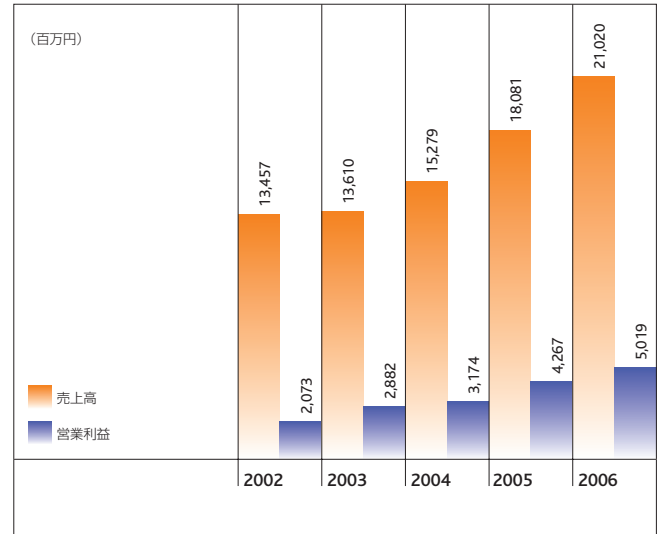
工作機械生産台数

(12月31日に終了した暦年)



計測機器事業 売上高/営業利益

(3月31日に終了した事業年度)



する必要があるので、生産ラインにおける製品変更に対して柔軟性に欠け、またデータが残らないという欠点があります。この解決策が三次元座標測定機であり、測定の際に使用するソフトウェアのプログラムの変更だけで、生産ラインの製品変更に対応することが可能となり、また測定データを保存しておくことができるようになります。その結果、近年、生産ラインで三次元座標測定機が使用されはじめました。三次元座標測定機への置き換えにより、ゲージの設計・製造コスト削減の方法をメーカーは模索しており、この流れは今後一層進むと思われます。さらに、国内自動車業界では、競争力強化のために品質保証のレベルを高める傾向が加速しています。その

ため、汎用計測機器では、従来の検査室での測定に代わり生産現場で測定したいというニーズが増加しています。当社ではこうした需要に対応する計測機器のラインアップを充実させ、さらなる事業の拡大に努めています。

このような状況に加え、ハードディスク・ドライブなどのデジタル機器向け計測機器、小型・高精度化に対応した計測機器、デジタル家電の液晶パネル向けなどのマーケットにおいても、汎用計測機器に対するニーズが拡大しています。

製品別では、三次元座標測定機は、カール ツァイス社製の解析・制御技術と当社の高剛性設計技術を融合した「ザイザックスSVA」シリーズが、お客様のニーズに合った製品として好調であり、

また、スキャニング高精度保証の「ザイザックスSVA fusion」も順調です。当期は、カール ツァイス社の新製品「GageMax」をインライン用三次元座標測定機として市場に投入しました。

また、表面粗さ・輪郭形状測定機「サーフコムC5」は、上述の検査室から生産現場への測定環境の変化に対応する計測機器で、厳しい条件の中でも高い性能を発揮できるのが特徴です。同製品は戦略商品の一つとして、各方面から強い関心が寄せられています。さらに、自動車メーカーでの表面粗さおよび真円度に関する新しいJIS規格の採用の拡大にともない、高精度な表面粗さ・輪郭形状測定機が好調です。製品としては、リニアモータ採用で世界最高精度と低振動を実現し

【1】三次元座標測定器
[ザイザックス SVA fusion]



三次元座標測定機は、測定物における対象(間)の寸法(または距離)をX・Y・Zの座標値で測定する装置です。「ザイザックス SVA fusion」は、販売が好調な当社の「SVA」にカール ツァイス社の世界唯一のテクノロジーである「アクティブスキャンングローブ」を搭載し、両社の技術を融合した競争力の高いモデルです。

【2】三次元座標測定器
[GageMax]



「従来の測定室での計測から生産現場でのライン計測へ」お客様のご要望にお応えし、世界で唯一生産現場環境で精度を保証し、省スペース設計、耐環境性を考慮した設計で、数々の最先端技術で構成されています。

た三次元表面粗さ形状測定機「サーフコム 1500DX」および輪郭形状測定機「コンターレコード1700DX」などが中心となっています。真円度・円筒形状測定機では、自動車メーカー向けに縦型の「ロンコム72A」および「ロンコム75GB」に強い引き合いがあります。さらに、新型の小型・高精度の「ロンコム44/54」シリーズも売上が拡大しています。

自動計測機器事業

当期の自動計測機器事業では、自動車産業の活発な設備投資を受けて、自動車の部品生産ラインなどで使用されるマシンコントロールゲージ「パルコム」シリーズが好調で、売上高は前年比で大きく伸びました。また、下期からハード

ディスク・ドライブ関連設備への投資が活発になり、ガラス基板の研磨機用の計測装置やハードディスク・ドライブ用スピンドルモーター計測機器が多く出荷されました。自動車産業での自動検査システムに対する需要の伸びも好業績を支えています。電気マイクロメータ「エルコム8 for wireless」は、無線により測定部と表示部の間でデータの送受信ができる製品で、測定部を持った作業者は自由に移動して測定することが可能となり、離れたところからでも測定中のデータを確認することができます。生産現場での各種ニーズを実現した画期的製品で、各方面から引き合いが強く、今後の売上への貢献が期待されています。

業務の多様化と海外展開

計測機器事業で今後取り組みたいと考えているのが、計測機器の校正認定サービス業務です。計測機器の校正認定とは、計測機器が正しい機能を有すると証明することで、認定事業者だけがこれを行うことができます。これまで校正の認定制度がなかった三次元座標測定機や真円度測定機に対する校正認定の制度が新たに導入されたため、校正サービスに対する新たな需要が期待されます。当社は認定業者としての認定を得ることはもちろん、これを売上増加の機会と捉えて積極的に進めていきます。

海外展開については、中国の営業拠点網の拡充と、欧州での拡販を進めていく計画です。中国では昨年広州と長春に拠

[3] 真円度測定器
[ロンコム 54DX]



真円度測定機は、円筒形状の真円度、同心度、円筒度などを測定する装置です。「ロンコム44/54」シリーズは、小型・普及機クラスを超えた高精度と高操作性を誇り、世界標準機として売上を好調に伸ばしています。

[4] マシンコントロールゲージ
[パルコム V10+V11(管制部)] [各種パルコム測定ヘッド]



マシンコントロールゲージは、加工中あるいは加工前後に測定したデータをもとに加工機を制御する装置で、加工不良防止や加工精度と生産性向上のために不可欠なシステムです。

点を設けており、2007年3月期には7ヶ所目となる拠点の開設を予定しています。欧州では、ドイツにあるグループ会社のAccretech (Europe) GmbHを拠点に、カール ツァイス社との連携を図りながら、欧州での計測機器の拡販していきます。

中期経営計画「AA60」の達成に向けて

計測機器事業での中期経営計画「AA60」の目標は、2009年3月期の売上高250億円、営業利益率25%です。これら目標の達成に向け、以下の4点を重要課題としています。

1つ目は、市場ニーズに合った製品群を充実させ、売上を拡大することです。これに向けては、ナノレベルでの計測の

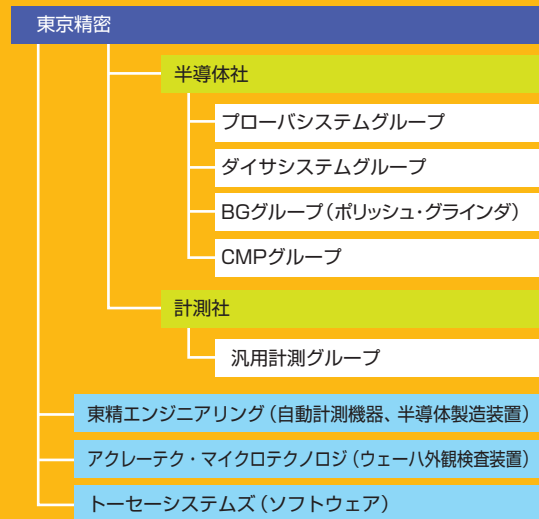
分野などで新製品の可能性を探り、チャレンジしていきたいと考えています。2つ目は、海外での売上を増大させることです。当社は1995年からカール ツァイス社と提携しており、開発および販売の両面でお互いの強みを活かしながら事業活動を展開してきました。今後は欧州での拡販に向けて連携をより強化し、海外売上の拡大を図ります。また、成長著しい中国・ASEAN諸国での拡販も大きな課題です。3つ目は、子会社の株式会社東精エンジニアリングと一体となって、サービス業務を強化し、売上高を伸ばしていくことです。そして4つ目は、生産性の向上およびコスト削減により、高収益を継続的に確保することです。計測機器事業では、これらの施策を

通し、計画初年度である2007年3月期の売上高目標を、約5%増の220億円とすることを目標としています。

研究開発活動と知的財産

「製品開発の原則」

1. 世界No.1の製品を創る。
マーケットシェアNo.1の商品は
(1) 好況時の利益の極大化が図れる。
(2) 不況時の損失の極小化が図れる。
2. 研究開発投資は自己資金で。
3. 開発は技術参入障壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い分野を狙う。
4. 相応しいパートナーを見つけ、開発コストをシェアするとともに開発の成果を共有する。



研究開発方針—「製品開発の原則」

「製品開発の原則」は、当社にとって単なる研究開発のための方針ではなく、当社の企業戦略といっても過言ではありません。当社が発展し続けるために最も重要なことは、強い製品開発体制と適正な製品開発基準を持つことです。当社は、「製品開発の原則」を経営の大原則とし、これに沿って技術開発を継続的に行っています。

研究開発体制

グループリーダー制

当社は、開発体制として、1988年より技術開発グループを製品群別に分け、技術者を各グループのヘッドとするグループリーダー制を採用しています。グループリーダーは、製品開発のみならず、担当する製品群の業績全般についての責任を持ち、事業計画作成、設備投資および人材の採用など大きな権限を与えられています。2002年4月、当社の執行役員制導入にともない、グループリーダーは執行役員に選任されました。これにより、グループリーダー制が備えている、開発計画などのスピーディーな意思決定や市場動向への迅速・柔軟な対応という長所が一層強化されました。

グループ開発体制

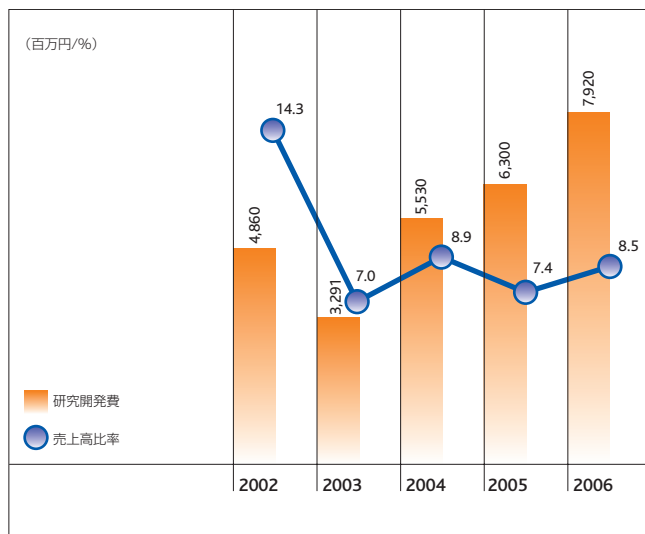
当社の子会社である東精エンジニアリングは、ウェーハ製造関連の半導体製造装置および自動計測機器の開発・製造・販売に特化し、ニッチマーケットに強い会社で、東京精密の計測社と一体となり、お客様のニーズに的確に対応し、最先端技術の世界No.1の製品を開発していくために一層の連携を図り迅速かつ機動的な事業運営を行っています。

同じく子会社であるアクレーテック・マイクロテクノロジーは、2000年に発売を開始した新規参入製品であるウェーハ外観検査装置の開発・製造・販売するために1997年に再編され、東京精密の開発グループと同様の機能を担っています。

さらに、子会社であるトーセイシステムズは、半導体社と計測社の製品に関連したソフトウェアの開発を行っています。各グループ会社は、東京精密とは相互の強みを活かした補完関係にあり、今後も研究開発活動を協力して行っていきます。

売上高に占める研究開発費の比率

(3月31日に終了した事業年度)



特許保有件数および出願件数

	特許権利保有件数	2005年度の特許出願件数
国内特許	375	171
外国特許	381	62

(2006年3月31日現在)

知的財産

知的財産重視の方針

東京精密は、技術参入障壁の高い分野において圧倒的な競争力を持つ製品を生産するため、最先端分野の研究開発を継続的に実施しています。こうして生み出された技術情報を中心とする知的財産を、今後の事業の付加価値の源泉と考え、特許取得や知的データベースの構築などに計画的な投資を行っています。

知的財産戦略

当社では、製品開発構想が生まれた時から製品出荷後の顧客対応に至るまでの各段階で、知財担当部署と技術部門が一体となって、他社の特許や技術動向の調査・評価を行います。さらに市場ニーズを踏まえて、競合企業よりも優位に立てる先端技術に関する特許の出願に力を入れるとともに、事業のグローバル化にとまない、海外でも積極的な権利取得に取り組んでいます。

また、特許の価値を重視し、保有する特許権利について、研究開発の進捗状況や製品市場における競合他社との位置関係なども考慮した上で、常に資産価値評価を行っています。価値の低い権利は破棄するなど、保有する特許の入れ替えをし、

貴重な知的財産のポートフォリオを形成しており、特許維持コストの効率化を図っています。

2006年3月期の状況

2000年以降に市場へ投入したポリッシュ・グラインダやウェーハ外観検査装置、CMP装置などの新規参入製品群と、受注が好調な既存製品群のプローバ装置やダイシング装置、自動計測機器などの競争力を高める特許出願を集中的に行いました。

現在における当社の半導体製造装置関連および計測機器関連の特許出願比率は約8:2です。

コーポレートガバナンス

基本的な考え方

当社は、経済のグローバル化が進み、企業の経営環境が目覚ましい変化を遂げる中、企業が持続的な成長を実現し、企業価値を高めていくためには、国際化と株主重視の経営に適合したコーポレートガバナンスの充実が不可欠と認識しています。

当社は、株主の権利と平等な扱いに留意するとともに、他のステークホルダーについても、権利を尊重し、円滑な関係の構築に努めています。株主をはじめとするすべてのステークホルダーの権利・利益を守るためには、適切な情報開示により透明性を確保することと、取締役会と監査役会が期待される機能を発揮することが重要であると考えています。

コーポレートガバナンス体制

1. 取締役・取締役会

当社の取締役会は、出身企業が多岐にわたる9名の取締役で構成されたハイブリッドな組織となっています。取締役会は議長を社長とし、毎月1回開催され、半期ごとの業務計画など重要事項の決定および取締役の業務執行状況の監督などを行っています。当社は社外取締役を選任していませんが、これは社外のチェックという観点において、社外監査役による監査が有効であると考えているためです。

さらに当社は、取締役会議長の諮問機関として、諮問委員会を設置しています。諮問委員会は監査役で構成されており、取締役の報酬や経営の諸テーマについて意見具申を行っています。

2. 監査役・監査役会

当社は、監査役の役割を活用したコーポレートガバナンスが有効と考え、監査役設置会社形態を採用しています。当社の監査役は、当社の大株主の出身の経営経験豊富な方々や監査・会計の専門家などで構成されており、その監査機能は高く、経営者の業務執行が適正かつ効率的に行われていることを監督しています。また、監査役機能の強化の観点より、2006年6月より5名に増員し、うち3名が社外監査役です。

監査役と社長直轄の監査室ならびに会計監査人の連携も緊密に行われており、監査体制、監査計画および実施状況などについて定期的に会合を持ち意見交換を行っています。

3. 社内カンパニー制および執行役員制

当社は、開発計画におけるスピーディーな意思決定や市場動向への迅速かつ柔軟な対応などを強化するために、2002年4月に社内カンパニー制と執行役員制を導入し、社内を半導体社、計測社、業務会社の3つのカンパニーに分けました。全てのオペレーションは、この3つのカンパニーで行い、本社としての機能は廃止しました。半導体社、計測社および業務会社は、完結した組織として、それぞれのお客様に一層機動的かつ迅速に対応できるようになりました。代表取締役社長CEOが定例の経営執行会議を毎月1回開催し、業務計画の進捗状況について監督などを行っています。

4. 監査室

当社は、代表取締役社長に直属する部署として、監査室を設置しています。監査室は、内部監査規定に則り計画的に監査を実施しており、定期的に監査実施項目および実施方法を検証し、必要があれば改訂を行います。

監査室の監査により、法令定款違反、会社規程違反またはその他の事由に基づく損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、監査室長は直ちに代表取締役社長に報告するとともに、是正・改善を指示し実施します。

5. 経営支援室

代表取締役社長に直属する当社の経営支援室が、グループに内在する諸問題または重大なリスク情報などを取り上げ、グループ全体の利益の観点から、グループにおける情報の共有と業務執行の適正を確保することに努めています。

経営支援室は、当社と子会社に関する不適切な取引または会計処理を防止するため、当社および子会社の監査室またはこれに相当する部署と十分な情報交換を行っています。

内部統制システムに関する基本的な考えおよびその整備状況

基本的な考え方

当社は、お客様、お取引先、株主の皆様、使用人など全てのステークホルダーの方々との間で、WIN-WINの関係を創り上げ、長期的に成長を持続させていくために、実効性ある内部統制システムとコンプライアンスの強化に取り組み、経営の健全性と透明性を確保し、グループ経営を行っています。

内部統制システムに関する整備状況

- ・ 当社は、取締役会が実効性ある内部統制システムの構築と法令定款遵守の体制の確立に努め、監査役会が内部統制システムの有効性と機能を監査します。
- ・ 社長直轄の組織として、監査室、経営支援室および輸出管理業務室を設け、当社と子会社に係る損失の危険の管理と業務の適正確保に努めます。
- ・ 当社は全社員の職務執行が法令・定款遵守に適合することを確保するために、「ACCURETECHグループ行動規範」を定めるとともに、「コンプライアンス委員会」、「情報セキュリティ委員会」、「環境管理委員会」、「安全衛生委員会」および「内部通報制度」などの体制を構築しています。
- ・ 当社は監査役の職務を補助する体制や、監査が実効的に行われることを確保する体制も構築しています。

環境への取り組み

社会・環境との「WIN-WIN」の関係を実現するために、東京精密は環境にやさしい事業活動の実現に努め、誠実で透明性の高い責任ある行動をとります。



環境・社会報告書2005

基本理念

当社は、「環境との調和による地球にやさしい仕事を目指す」をモットーに、地球環境保全が人類共通の重要課題であることを認識し、生産・サービスの全域において積極的に環境保全に配慮した行動をとることを基本理念としています。

環境基本方針

環境保全活動の基本方針は、全社員が、生産からサービスまで全ビジネス領域において、常に「この行動は地球にやさしいか」を配慮し、環境負荷を可能な限り少なくする努力をすることです。当社では、「環境管理委員会」が中心となって環境管理体制を組織し、環境関連の法律、条令、協定および当社の「環境方針」を遵守し、環境保全活動を推進しています。

また、全社員に対し環境保全に関する教育普及を行い、意識の向上を図るとともに、協力会社の工場に対しても当社の環境保全活動への理解が得られるよう努力しています。

環境行動方針

1. 「環境管理委員会」を頂点とする、全職制を軸にした環境管理体制を組織し、揺るぎない環境保全活動を推進する。
2. 環境関連の法律、条例、協定および本「環境方針」を遵守し、自主目標を設定して、汚染防止、環境保全に取り組む。
3. 環境に配慮した製品の開発・改善に努める。
4. 事業活動にともなう環境影響に関する以下の項目等について環境目的・環境目標に定め、継続的な活動を行うとともに内部監査などで見直しを行う。
 - ▶省エネルギー・省資源・廃棄物の削減・リサイクルへの取り組み、天然資源の有効利用
 - ▶有害物質の適性管理による汚染の予防、環境負荷の高い物質の使用量削減
 - ▶環境に配慮した新製品の開発および既存製品の改良
5. 全社員に対し、環境保全に関する教育訓練を行い、意識の向上を図る。また、協力工場に対しても環境保全活動についての理解と協力を求める。
6. この「環境方針」は社内外に開示する。

環境・社会報告書の発行

当社では、毎年10月に環境・社会報告書を発行しています。この報告書は当社のWebサイトでもご覧いただけます。

<http://www.accretech.jp/>

ホーム≫会社案内≫環境への取り組み

役員紹介



鈴木 貞勝



藤森 一雄



長澤 英二



太田 邦正

取締役及び監査役 (2006年6月29日現在)

代表取締役社長CEO兼COO
鈴木 貞勝

代表取締役EVP
藤森 一雄
長澤 英二
太田 邦正

取締役
梅中 茂
ウォルフガンク・ボナッツ
グレッグ・セバスチャン
吉田 均
木村 龍一

常勤監査役
高城 英明
監査役
吉儀 肇
山本 清次
久富 眞志
川原 栄次

Financial Section

6年間の主要財務データ

株式会社東京精密及び連結子会社
3月31日に終了した年度

						百万円	千米ドル
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2006
会計年度:							
売上高	¥73,172	¥34,064	¥47,171	¥62,324	¥ 84,750	¥ 92,845	\$790,373
営業利益(損失)	15,032	(1,757)	1,860	5,947	13,051	13,991	119,109
当期純利益(損失)	7,237	(2,026)	74	(3,783)	4,459	3,125	26,606
会計年度末:							
総資産	91,477	79,865	88,669	94,893	100,993	109,875	935,350
株主資本	38,779	35,423	33,645	29,183	33,003	46,703	397,576
有利子負債	17,522	31,145	33,531	36,253	31,273	27,726	236,030
						円	米ドル
1株当たり:							
当期純利益(損失) — 希薄化前	¥192.95	¥(54.21)	¥ 1.64	¥(101.67)	¥ 118.82	¥ 80.77	\$ 0.68
— 希薄化後	192.21	—	1.64	—	108.75	74.02	0.63
従業員数(人)	1,160	1,146	1,101	1,100	1,144	1,169	

フィナンシャルセクション

目次

6年間の主要財務データ 24
財務概況 25
連結貸借対照表 30
連結損益計算書 32
連結株主持分計算書 33
連結キャッシュ・フロー計算書 34
連結財務諸表注記 35
独立監査人の監査報告書 47

財務概況

概況

当社は、半導体製造装置および計測機器のメーカーです。市場の変化が激しく、常に最新技術が要求される環境下において、当社が持続的な成長を続けていくためには、適正な基準に準拠した製品開発を、強力な体制で行っていくことが重要となります。そのため、独自の「製品開発の原則」に則った経営を行うことにより、市場の設備投資動向による影響を最小限に抑えながら、高成長・高収益のビジネス基盤を構築しています。

当社は、対処すべき課題として、新製品事業の成功と財務構成の改善を掲げています。当社は、ここ数年来、半導体新規参入製品の開発を積極的に進めてきました。新規参入製品の中で、「ポリッシュ・グラインダ」は、計画通りの利益を上げていますが、「ウェーハ外観検査装置」と「CMP装置」は、顧客開拓が進んでいるものの、まだ利益面で課題を残しています。今後、「ウェーハ外観検査装置」と「CMP装置」につきましても、売上拡大とコストダウンにより、利益率を計画ラインまで向上させていくように

注力いたします。

当社の財務構成は、半導体旧機種やリール（LEEPL:Low Energy E-beam Proximity projection Lithography, 低加速電圧電子ビーム近接投影露光技術）装置関連資産の処分などにより、格段に改善されました。今後新しい中期計画「AA60」の推進による、売上・利益の拡大、フリー・キャッシュ・フローのプラスおよび転換社債型新株予約権付社債の資本への転換などにより、財務諸比率のさらなる向上を図ります。

売上高

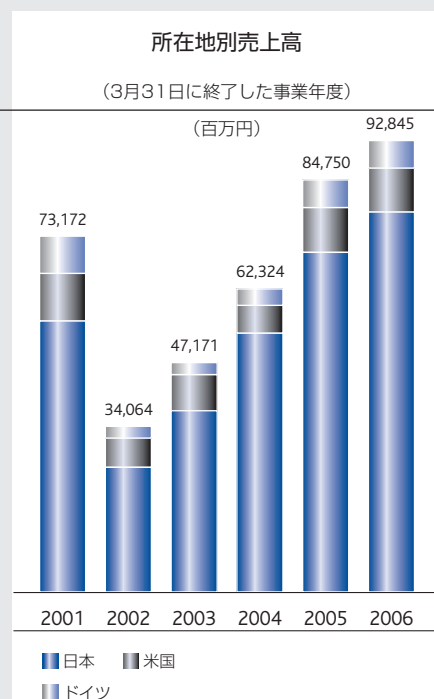
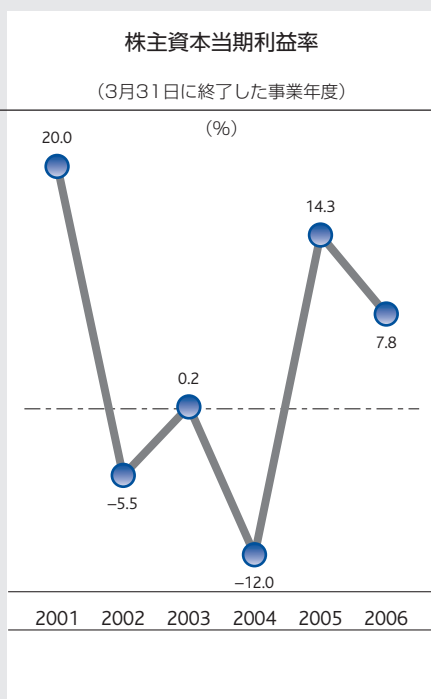
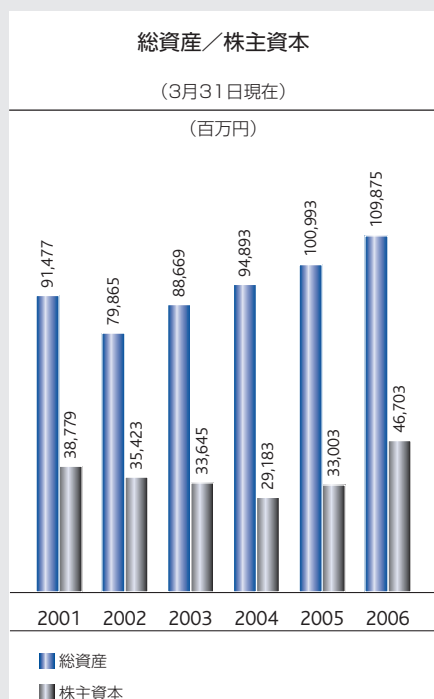
2006年3月期の売上高は、当社を取り巻く経営環境が半導体製造装置部門、計測機器部門とも非常に良好であったため、前期比9.6%増の92,845百万円となり、2年連続の既往ピーク更新となりました。

半導体業界は、薄型テレビ・携帯音楽プレーヤーなどのデジタル・コンシューマ機器の需要増やパソコンの好調などにより、半導体メーカーの設備投資は旺盛で、製造装置に対する需要も伸長しました。これを反映して、半導体製

造装置部門の売上高は、前期比7.7%増の71,824百万円と過去最高を更新しました。

計測機器部門も、好調が続く自動車業界や工作機械業界などのユーザーニーズを確実に受注に取り込む営業努力により、売上高は前期比16.3%増の21,020百万円と過去最高を更新し、2003年度以降、3期連続既往ピークを更新しています。

地域別に見ると、半導体製造装置部門の売上高は、国内、海外とも前期比大幅に伸びました。海外では東アジア地区が好調で、特に韓国・中国向けが大きく伸長しました。計測機器部門の売上高は、国内が特に大きく伸長しましたが、海外も前期を上回ることができました。半導体製造装置、計測機器合算で見ると、東アジアへの売上高は前期比24.7%増の31,224百万円、北米は前期比13.8%減の7,043百万円、ヨーロッパは前期比11.8%減の5,034百万円、その他の地域は前期比11.1%増の4,374百万円となりました。結果として、海外売上高は前期比11.2%増の47,676百万円となり、全体の51.3%を占めました。



【半導体製造装置部門】

既存製品群の主力であるウェーハプロービングマシンについては、デバイス需要の好調とウェーハでのフルテストの必要性の高まりなどを背景に、市況は極めて活発でした。あらゆるデバイスメーカーのニーズをカバーするフルオートタイプである300mm対応機の「UF3000」が前期比大きく伸張するとともに、台湾向けなどに200mm対応機の「UF200」シリーズも堅調に推移し、過去最高の売上高を達成し、当社業績の柱となっています。当社は、ウェーハプロービングマシンのNo.1プレーヤーとして、世界的にシェアをさらに拡大しています。

ウェーハダイシングマシンも、「A-WD-300T」および「A-WD-200T」が、お客様より高い評判を得て、堅調に推移しました。また、2005年3月期より販売開始した新型レーザーダイシング装置「MAHOHDICING MACHINE」は、ユーザーから性能および生産性を高く評価され、当期の販売は、MEMS向けや薄物ウェーハ向けに前期比倍増となりました。リピートオーダーも

増加しており、今後の拡販が期待されます。

新規参入製品群のウェーハ外観検査装置は、低いコスト・オペ・オーナーシップや高い欠陥検出率などが高く評価され、既存ユーザーからリピートオーダーをいただくとともに新規ユーザーも増えており、新たに高いスループットのシリーズを加えて、多岐にわたるユーザーニーズに応えています。

また、ウェーハ薄片化において他の追随を許さない独自製品であるポリッシュ・グラインダは、市場でのデファクトスタンダードとなりました。300mmウェーハ対応機である「PG300RM」の需要が急拡大し、受注・売上とも前期比大幅に増え、過去最高となりました。薄物ウェーハのニーズは、引き続き増加していくと考えられています。

さらに、CMP装置も、「ChaMP」シリーズのコンセプトや構造の優位性がお客様に浸透し、新規ユーザーの獲得に向けて、性能評価が順調に進んでいます。酸化膜のみならず、高度な研磨技術が要求される銅配線などで高い評価をいただいております。今後が期待されます。

【計測機器部門】

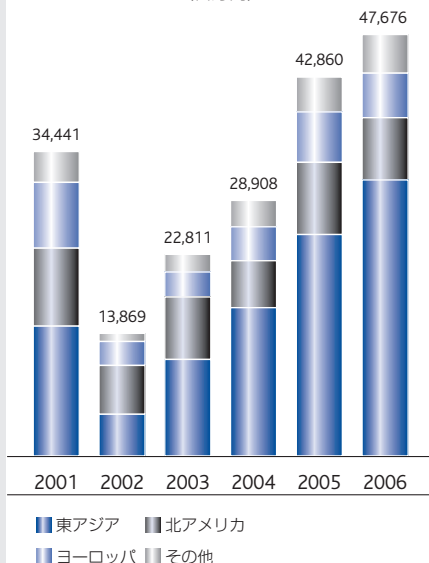
汎用計測機器では、カール ツァイス社の解析・制御技術と当社の高剛性設計技術を融合した三次元座標測定機「ザイザックスSVA」シリーズが、お客様のニーズに合った製品として好調であり、スキャニング高精度保証の「ザイザックスSVA fusion」も順調です。当期に市場投入したカール ツァイス社の新製品「ゲージマックス」は、インラインで使用される三次元座標測定機で、今後の伸びが期待されます。また、リニアモータ採用で世界最高精度と低振動を実現した表面粗さ形状測定機「サーフコム」シリーズも、「サーフコム1500DX」や「コンターレコード1700DX」などを中心に堅調に推移しています。高精度で高評価を得ている真円度測定機「ロンコム」シリーズでは、「ロンコム54/44」や「ロンコム72/75」などがラインアップに加わり、売上が拡大しています。

自動計測機器は、自動車産業の活発な設備投資を受けて、自動車の部品生産ラインなどで使用される「パルコム」シリーズが好調で、売上高は前年比で大きく伸びました。

海外売上高

(3月31日に終了した事業年度)

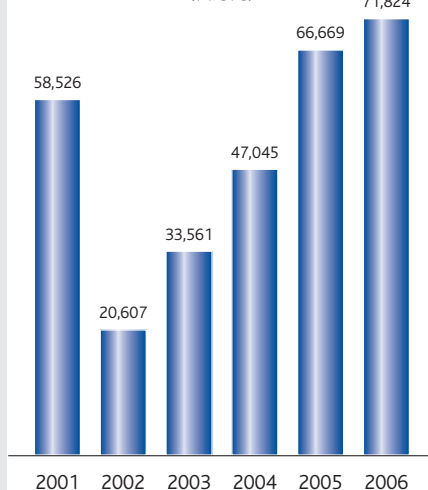
(百万円)



半導体製造装置部門売上高

(3月31日に終了した事業年度)

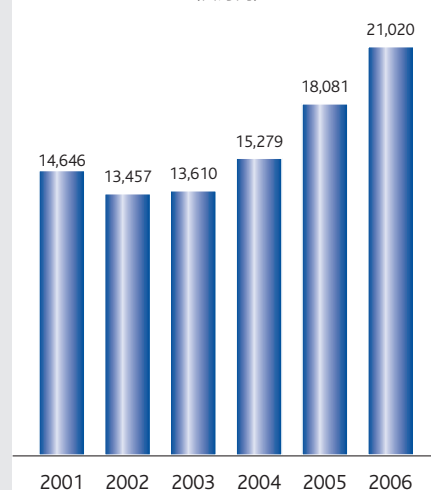
(百万円)



計測機器部門売上高

(3月31日に終了した事業年度)

(百万円)



売上原価

2006年3月期の売上原価は、前期比11.0%増加し65,873百万円となり、売上原価比率は70.0%から70.9%へと若干増加しました。これは、固定費削減、内製化推進による変動比率引き下げなどのコストダウン施策を推進したものの、売上の製品構成が変わったことなどによるものです。

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費は、販売費が9,264百万円、一般管理費が3,715百万円となり、合算では前期比5.1%増加し12,980百万円となりました。販売費は売上高の増加にもかかわらず減少しましたが、一般管理費は開発費の増加などにより増加しました。しかし、売上高販売費率としては2005年3月期の14.6%から14.0%へと低下しました。

営業利益

2006年3月期は、前期比7.2%増の13,991百万円の営業利益を計上し、売上高営

業利益率は15.4%から15.1%になりました。

部門別の内訳については、半導体製造装置部門は、売上増加とコストダウン推進が寄与し、前期比2.1%増の8,972百万円の営業利益を計上し、増益となりました。計測機器部門は、販売面だけではなく、生産面でもコストダウンに注力し、前期比17.6%増の5,019百万円の営業利益を計上し、3期連続で過去最高を更新しました。

営業外収益および費用

2006年3月期の営業外収益は、主として為替差益の増加を理由として、前期比597百万円増加し、875百万円となりました。また営業外費用は、主として固定資産除却損などにより、前期比392百万円増加し、835百万円となりました。

当期純利益

当社は、財務体質改善と今後の収益基盤強化の観点より、特別損失を6,281百万円計上しました。この主な内訳は、半導体製品の旧機

種についてのたな卸評価損及び廃却損約28億円と、リープ関連設備の固定資産除却損およびリース解約費用約32億円などです。これにより、より強固な財務基盤の構築が可能となりました。

この結果、税金等調整前当期純利益は、7,865百万円となり、これより税金および少数株主利益等を加減し、29.9%減少しました。当期の配当に関しては、中間配当として一株当たり20円を実施しました。期末配当も特別損失はありましたが、長期的視点で保有していただいている株主の皆様の視点と当社の財務状況を踏まえ、一株当たり20円を継続し、一株当たり年間配当で40円を実施しました。

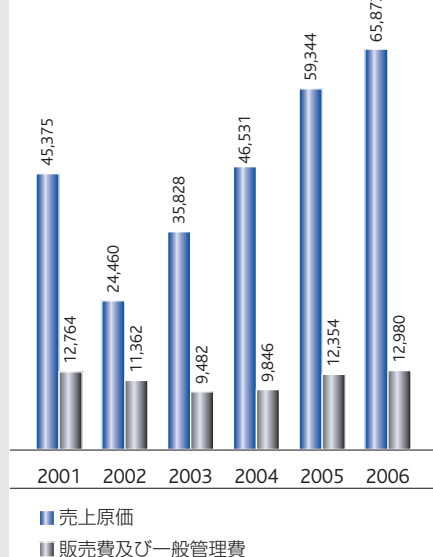
研究開発費

試験研究費は、前期比25.7%増加し、7,919百万円となりました。当社は、「製品開発の原則」(18ページ参照)に則り、引き続き世界No.1の製品開発に注力しています。半導体製造装置部門では、ウェーハの大口径化や微細化・薄片化への対応など、市場ニーズにマッチ

売上原価／販売費及び一般管理費

(3月31日に終了した事業年度)

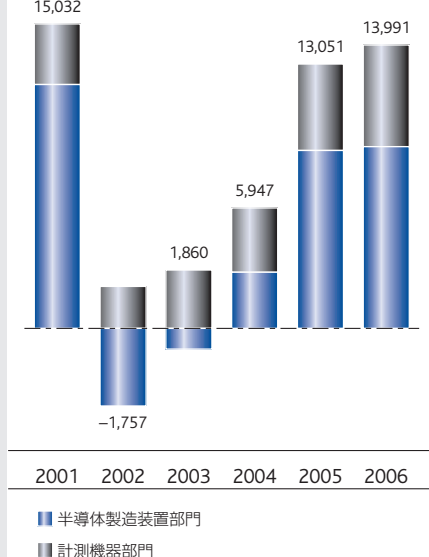
(百万円)



営業利益

(3月31日に終了した事業年度)

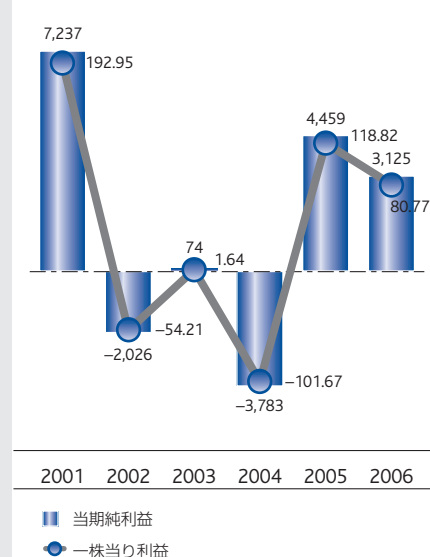
(百万円)



当期純利益／一株当たり利益

(3月31日に終了した事業年度)

(百万円/円)



した次世代装置をタイムリーに投入していくための試験研究に注力します。また、計測機器部門でも、高精度かつ高いコストパフォーマンスを実現した新機種を引き続き投入していきます。

設備投資

設備投資は、前期比5.5%増加し3,978百万円となりました。この増加は、土浦・八王子の工場新設や内製化への移行のための設備投資を主な理由としており、2007年3月期は従来水準に戻る予定ですが、市場環境を勘案しながら柔軟に対応する予定です。また、減価償却費は、前年とほぼ同額の2,768百万円となりました。

為替

当社は、為替に関し、一部北米を除き原則として円建てで取引を行っていますので、為替変動によるリスクを低く抑えることが可能となっています。外貨建て取引を行っている米国子会社などに対する売掛金については、為替変

動のリスクに備えるため、必要に応じて為替予約取引を利用しています。この取引は実需に基づく為替予約に限定しており、投機目的などのデリバティブ取引は行っていませんので、リスク管理は正当に遂行されています。

貸借対照表

2006年3月末の総資産は前期比8,882百万円増の109,875百万円となりました。

流動資産は前期比7,315百万円増の81,067百万円となりました。資産の増加は、現金及び預金の増加ならびに売上増に伴う売上債権の増加などによるものです。

固定資産は1,567百万円増加し、28,807百万円となりました。半導体社および計測社の八王子と土浦に新設した新工場関連設備や内製強化のための300mm対応機械設備を増加したことを主な理由としています。

負債合計は、前期比2,307百万円減の63,172百万円となりました。これは、生産増加にともなう仕入債務が増加したものの、ユーロ円転換社債や未払金が減少したためです。有

利子負債は3,547百万円減少しました。

少数株主持分は、株式会社東精エンジニアリングを完全子会社化したことにより0になりました。

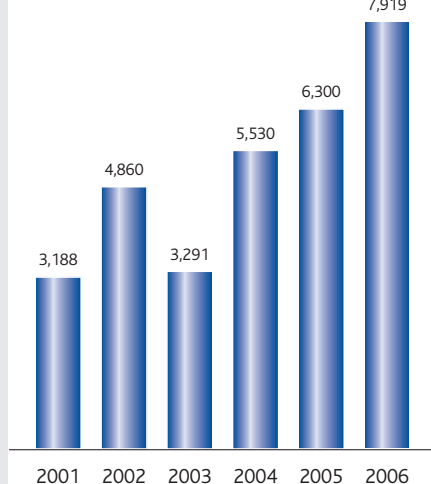
自己資本比率は42.5%となり、前期より大幅に上昇しました。2007年3月期は、51.3%にアップする予定であり、2～3年後には60%を目標に改善を図っていきます。

当社の総資産回転率は、2000年度までは約1回転でしたが、ここ数年、シリコンサイクルのボトムによる既存製品群の回転率の低下や新規参入製品群の負担によって悪化していました。しかし、既存製品群の総資産回転率は、2006年3月期はほぼ従来水準に戻っており、新規参入製品群の資産回転率も着実な売上高の上昇により、2006年3月期は0.9と改善されました。同様に在庫回転率も改善しており、2006年3月期の在庫回転率は3.4となりました。

研究開発費

(3月31日に終了した事業年度)

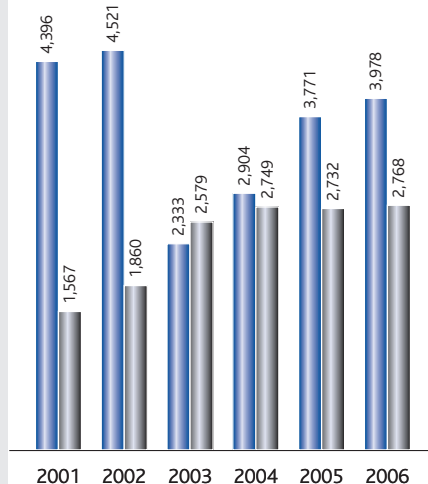
(百万円)



設備投資／減価償却費

(3月31日に終了した事業年度)

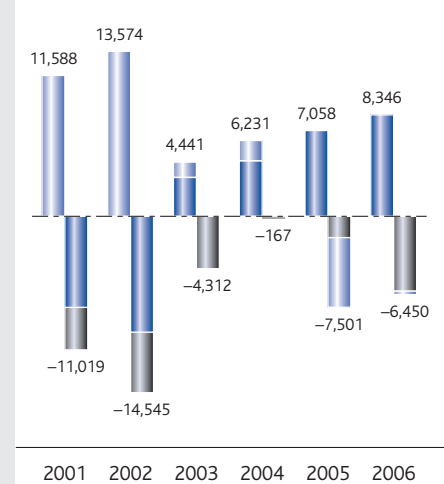
(百万円)



キャッシュ・フロー

(3月31日に終了した事業年度)

(百万円)



キャッシュ・フロー

2006年3月期末における現金及び現金同等物は、前期末より2,012百万円増加し、13,851百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは8,346百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益7,865百万円、減価償却費2,768百万円、売上債権の増加4,043百万円、たな卸資産の減少1,152百万円、仕入債務の増加6,546百万円などによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは6,160百万円の支出となりました。これは有形固定資産の取得4,821百万円や定期預金の預入1,048百万円などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは290百万円の支出となりました。これは主に、短期借入金の増加2,598百万円、長期借入金の減少2,160百万円および配当金の支払1,312百万円などによるものです。

今後も売上拡大と利益計上などにより、営業キャッシュ・フローのプラスが見込まれ、より良い財務状況を構築できる見込みです。

リスク要因

会社の今後の業績に影響を与えるリスク要因としては以下のようなものが考えられます。

市場の変動

半導体業界は、情報化社会の進展の中で長期的には拡大基調を続けていくものの、シリコンサイクルは今後も起こり得ます。市場変動により半導体製造装置部門の業績に影響を受ける可能性があります。当社グループはそのような市場変動の中でも継続的に利益を確保できる収益体質の構築に注力しています。

為替レートの変動

輸出取引については、円建てを原則としていますが、米国など一部ユーザーとは米ドル建てとなっています。為替予約などを活用しリスクヘッジを行っていますが、為替レートに予期せぬ変動が生じた場合、当社グループ業績に影響を与える可能性があります。

知的財産権の保護

当社グループの製品はいずれも最先端技術を搭載したブランド力のある製品で、その特許関係の権利帰属および商標・ブランドの保護などに特別の配慮をし、会社の利益が損なわれないように施策を講じていますが、やむを得ず第三者との間で権利関係をめぐる訴訟などが発生した場合は、業績に影響が及ぶ可能性があります。

カントリーリスクその他

当社グループは全世界で事業展開をしており、各国の法的規制の下で最適な事業活動を行っていますが、各国の予期せぬ法的規制の変更が当社グループの業績に影響を与える可能性がないとはいえません。また、一般的可能性としてテロ、戦争、自然災害などの予期せざる事象が発生した場合も、業績に影響が及ぶ可能性があります。

連結貸借対照表

株式会社東京精密及び連結子会社
2005年及び2006年3月31日に終了した年度

資産	百万円		千米ドル (注1)
	2005	2006	2006
流動資産:			
現金及び現金同等物(注14)	¥ 11,866	¥ 13,887	\$118,218
受取手形及び売掛金	32,105	36,437	310,188
たな卸資産(注4)	28,134	27,053	230,304
繰延税金資産(注7)	753	1,447	12,326
その他	951	2,294	19,535
貸倒引当金	(60)	(53)	(459)
流動資産合計	73,752	81,067	690,114
有形固定資産:			
土地(注5)	2,917	2,937	25,006
建物及び構築物(注5)	12,667	12,474	106,191
機械装置	4,561	5,030	42,820
建設仮勘定	529	518	4,412
その他	3,726	3,689	31,408
	24,402	24,649	209,839
減価償却累計額	(10,517)	(10,332)	(87,955)
有形固定資産合計	13,885	14,317	121,884
無形固定資産:			
ソフトウェア	2,263	1,451	12,354
営業権	221	3,301	28,108
その他	96	83	713
無形固定資産合計	2,581	4,837	41,176
投資その他の資産:			
投資有価証券(注3)	3,394	5,662	48,199
非連結子会社及び関連会社への投資	262	299	2,551
繰延税金資産(注7)	6,331	1,907	16,239
その他	796	1,793	15,269
貸倒引当金	(10)	(9)	(84)
投資その他の資産合計	10,773	9,653	82,175
固定資産合計	27,240	28,807	245,236
資産合計	¥100,993	¥109,875	\$935,350

添付の注記は連結財務諸表の一部である。

負債及び資本	百万円		千米ドル (注1)
	2005	2006	2006
流動負債:			
支払手形及び買掛金	¥ 17,809	¥ 24,807	\$211,181
短期借入金(注5)	5,068	6,830	58,142
未払費用	2,133	1,788	15,226
未払税金	2,890	1,193	10,161
その他	7,038	3,480	29,625
流動負債合計	34,941	38,099	324,336
固定負債:			
長期債務、1年内を除く(注5)	26,204	20,896	177,887
退職給付引当金(注6)	4,286	4,175	35,549
繰延税金負債(注7)	46	-	-
固定負債合計	30,538	25,072	213,436
少数株主持分	2,510	-	-
偶発債務(注11)			
資本(注8,16):			
資本金			
授權株式数 : 110,501,100株(2006年)			
: 110,501,100株(2005年)			
発行済株式数: 40,100,167株(2006年)		9,447	80,425
: 37,517,954株(2005年)	7,392		
資本剰余金	12,017	20,466	174,228
利益剰余金	13,596	15,399	131,093
その他有価証券評価差額金	70	1,340	11,411
為替換算調整勘定	(9)	139	1,183
自己株式: 26,421株(2006年)		(90)	(766)
: 22,229株(2005年)	(63)		
資本合計	33,003	46,703	397,576
負債及び資本合計	¥100,993	¥109,875	\$935,350

連結損益計算書

株式会社東京精密及び連結子会社
2005年及び2006年3月31日に終了する年度

	百万円		千米ドル (注1)
	2005	2006	2006
売上高	¥84,750	¥92,845	\$790,373
売上原価 (注12)	59,344	65,873	560,767
売上総利益	25,405	26,971	229,606
販売費及び一般管理費 (注12)	12,354	12,980	110,496
営業利益	13,051	13,991	119,109
営業外収益:			
受取利息	10	19	165
その他収益	267	855	7,284
営業外費用:			
支払利息	293	272	2,317
その他費用	150	563	4,793
経常利益	12,885	14,031	119,448
特別利益:			
投資有価証券売却益	358	93	799
その他利益	165	22	188
特別損失:			
たな卸資産評価損及び廃却損	5,861	2,862	24,371
固定資産除却損	854	1,387	11,807
リース解約費用	—	1,854	15,781
その他損失	291	178	1,516
税金等調整前当期純利益	6,401	7,865	66,959
法人税等 (注7):			
当年度分	3,187	1,690	14,387
法人税等調整額	(1,688)	2,851	24,276
	1,498	4,541	38,663
少数株主利益	444	198	1,689
当期純利益	¥ 4,459	¥ 3,125	\$ 26,606

	円		米ドル (注1)
	2005	2006	2006
1株当り (注13):			
純資産	¥879.93	¥1,165.07	\$9.92
当期純利益 — 希薄化前	118.82	80.77	0.68
— 希薄化後	108.75	74.02	0.63
年間配当額	30.00	40.00	0.34

添付の注記は連結財務諸表の一部である。

連結株主持分計算書

株式会社東京精密及び連結子会社
2005年及び2006年3月31日に終了する年度

	千株	百万円			その他
	株式数	資本金	資本剰余金	利益剰余金	
2004年3月31日残高	37,354	¥7,199	¥11,806	¥10,273	¥ (97)
当期純利益	-	-	-	4,459	-
為替換算調整勘定	-	-	-	-	95
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	12
自己株式	(4)	-	-	-	(13)
新株引受権の権利行使	144	192	211	-	-
配当金	-	-	-	(1,122)	-
役員賞与	-	-	-	(14)	-
2005年3月31日残高	37,495	7,392	12,017	13,596	(3)
当期純利益	-	-	-	3,125	-
為替換算調整勘定	-	-	-	-	149
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	1,270
自己株式	(4)	-	175	-	(26)
新株予約権の権利行使	180	287	287	-	-
転換社債型新株予約権付社債の転換	690	1,767	1,767	-	-
株式交換	1,711	-	6,218	-	-
配当金	-	-	-	(1,312)	-
役員賞与	-	-	-	(9)	-
2006年3月31日残高	40,073	¥9,447	¥20,466	¥15,399	¥1,389

	千米ドル(注1)			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	その他
2005年3月31日残高	\$62,927	\$102,305	\$115,744	\$ (26)
当期純利益	-	-	26,606	-
為替換算調整勘定	-	-	-	1,269
その他有価証券評価差額金	-	-	-	10,811
自己株式	-	1,491	-	(226)
新株予約権の権利行使	2,450	2,449	-	-
転換社債型新株予約権付社債の転換	15,047	15,045	-	-
株式交換	-	52,937	-	-
配当金	-	-	(11,171)	-
役員賞与	-	-	(85)	-
2006年3月31日残高	\$80,425	\$174,228	\$131,093	\$11,828

添付の注記は連結財務諸表の一部である。

連結キャッシュ・フロー計算書

株式会社東京精密及び連結子会社
2005年及び2006年3月31日に終了する年度

	百万円		千米ドル (注1)
	2005	2006	2006
営業活動によるキャッシュ・フロー:			
税金等調整前当期純利益	¥ 6,401	¥ 7,865	\$ 66,959
減価償却費*	2,892	2,939	25,023
貸倒引当金の増減	16	(8)	(70)
退職給付引当金の増減	231	(110)	(941)
受取利息及び受取配当金	(51)	(75)	(641)
支払利息	293	272	2,317
投資有価証券評価損	-	60	510
ゴルフ会員権評価損	2	44	374
土地売却益	(15)	(1)	(11)
固定資産売却・除却損	952	1,704	14,512
無形固定資産除却損	-	19	162
投資有価証券売却益	(358)	(93)	(799)
売上債権の増加	(5,427)	(4,043)	(34,422)
たな卸資産の減少	1,006	1,152	9,810
仕入債務の増加	37	6,546	55,729
その他資産負債の増減	2,532	(4,443)	(37,826)
役員賞与	(14)	(9)	(85)
小計	8,499	11,817	100,603
利息及び配当金の受取額	51	75	641
利息の支払額	(291)	(284)	(2,425)
法人税等の支払額	(1,201)	(3,261)	(27,766)
営業活動により増加したキャッシュ	7,058	8,346	71,052
投資活動によるキャッシュ・フロー:			
預入期間3ヶ月を超える定期預金の払込	(21)	(1,048)	(8,921)
預入期間3ヶ月を超える定期預金の払出	20	38	323
投資有価証券の取得による支出	(362)	(140)	(1,195)
関係会社有価証券の取得による支出	(96)	(163)	(1,394)
投資有価証券の売却による収入	579	85	727
有形固定資産の取得による支出	(1,721)	(4,821)	(41,047)
有形固定資産の売却による収入	78	87	747
無形固定資産の取得による支出	(277)	(242)	(2,067)
その他	30	44	382
投資活動により減少したキャッシュ	(1,769)	(6,160)	(52,446)
財務活動によるキャッシュ・フロー:			
短期借入金の増減	(5,085)	2,598	22,116
長期借入れによる収入	5,300	2,500	21,282
長期借入金の返済による支出	(4,994)	(4,660)	(39,670)
社債償還による支出	(200)	(450)	(3,830)
新株引受権(又は新株予約権)の権利行使による収入	383	646	5,503
自己株式の売却収入	-	495	4,215
配当金の支払額	(1,122)	(1,312)	(11,171)
その他	(13)	(108)	(920)
財務活動により減少したキャッシュ	(5,732)	(290)	(2,475)
現金及び現金同等物の換算差額	39	117	1,000
現金及び現金同等物の増加(減少)額	(403)	2,012	17,131
現金及び現金同等物の期首残高	12,242	11,838	100,782
現金及び現金同等物の期末残高(注14)	¥11,838	¥13,851	\$117,914

添付の注記は連結財務諸表の一部である。

(※)減価償却費には連結調整勘定の償却額が含まれている。

連結財務諸表注記

株式会社東京精密及び連結子会社

1 連結財務諸表の基本事項

株式会社東京精密(以下 当社)及びその連結子会社の連結財務諸表は、日本の証券取引法及び関連する諸規則に基づき日本において一般に公正妥当と認められる会計原則及び慣行に従って作成されている。日本で一般に公正妥当と認められる会計原則及び慣行は、いくつかの点で国外において一般に公正妥当と認められる会計原則及び慣行と相違する可能性がある。添付の連結財務諸表を国外において一般的な表示様式とするため、表示の組替を行っている。連結財務諸表の注記事項には、日本で一般に公正妥当と認められる会計原則及び慣行では認められていない財務情報が追加的に含まれている。連結財務諸表上の米ドル金額は、

便宜上記載されたものであり、2006年3月31日における実勢為替相場1米ドル=117円47銭で換算されている。換算額は、当該レートまたは他の換算レートにより円貨をドル貨に交換した、または交換できたことを示すものではない。

百万円未満の金額を切り捨てて表示しているため、連結財務諸表上の合計金額(円及び米ドル)は個々の金額の合計値とは必ずしも一致しない。前年度の連結財務諸表に記載された一部の金額は、当年度の表示方法に合わせて組替表示している。

2 重要な会計方針の要約

(1) 連結の方針

添付の連結財務諸表は2005年3月31日現在における子会社8社及び2006年3月31日現在における子会社7社を連結している。2005年3月31日現在における残りの子会社8社及び関連会社1社及び2006年3月31日現在における残りの子会社10社は、その総資産、売上高及び利益に重要性がないため連結対象から除いている。

2006年3月31日に終了した事業年度において、連結子会社の取得日における投資原価と純資産の公正価値との差額は、その個別案件ごとに判断し、合理的な年数(10年)にわたり、定額法にて償却している。

すべての重要な関係会社間の取引、勘定及び未実現利益は消去している。重要性のない関連会社及び非連結子会社への投資は、取得原価あるいはそれ以下の金額で評価されている。当該投資に回復見込みのない減損が生じた場合には、評価減を実施している。剰余金の処分は株主総会決議がなされた期において認識している。

(2) 現金及び現金同等物

現金及び現金同等物には手許現金、要求払い預金及び短期かつ流動性の高い投資で、取得時において満期が3ヶ月以内の価値変動リスクが僅少なものからなっている。

(3) 有価証券

投資有価証券のうち、時価のあるものについては時価で評価し、その未実現損益は利益の構成要素とはせず、税効果控除後の金額で資本の部の独立項目としている。売却された有価証券の売却原価は移動平均法に基づいて計算している。

投資有価証券のうち、時価のないものについては移動平均法による原価法で評価している。

(4) デリバティブ取引

デリバティブ取引は、一般的に時価で評価されることが求められている。しかしながら、当社は輸出取引に際して発生する為替変動リスクの回避を目的とした為替予約取引と借入金に際して発生する金利変動リスクの回避を目的とした金利スワップ取引を利用している。金融商品に係る会計基準で容認されている為替予約の振当処理と金利スワップの

特例処理を適用している。投機目的のデリバティブ取引は行っていない。契約先は国内の高い信用を持った銀行であるため、当社は相手先の為替予約契約不履行によるいかなる信用リスクも想定していない。当社は国内規則に従い重大な為替変動リスクと金利変動リスクをヘッジしている。

(5) たな卸資産

当社及び国内の連結子会社のたな卸資産は、仕掛品を除き、先入先出法による原価法を採用している。仕掛品は個別法による原価法によっている。

国外の連結子会社のたな卸資産は先入先出法による低価法で評価している。

(6) 有形固定資産

有形固定資産は取得原価で表示している。当社及び国内の連結子会社における減価償却は各資産毎に見積残存期間に基づき、主として定率法によっている。

国外の連結子会社における減価償却は見積残存期間に基づく定額法によっている。

主な耐用年数は以下のとおりである。

建物及び構築物	3年～50年
機械装置及び運搬具	2年～11年

(7) 無形固定資産

無形固定資産は取得原価から減価償却累計額を控除した金額で表示している。販売用ソフトウェアは、予定販売数量に対する当期の販売数量の比率ないし残存有効期間に基づく定額法のうち、いずれか大きい金額で減価償却している。自社利用のソフトウェア及びその他の無形固定資産は、それぞれ社内における利用可能期間及び使用可能期間に基づく定額法によっている。

(8) リース

解約不能なリース取引は、原則として、オペレーションリースとして処理している。ただし、リース期間満了時にリース物件の所有権が移転するリース取引については、ファイナンスリースとして処理している。

(9) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため貸倒引当金を計上している。貸倒引当金は個々の貸倒懸念債権の回収可能性及び過去の貸倒実績に基づき、見積回収不能額を計上している。

(10) 退職給付引当金

退職給付引当金は事業年度末の退職給付債務及び年金資産の見積りに基づき計上している。

数理計算上の差異は、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)にわたり定額法で翌年度から費用処理している。

また、当社及び国内の連結子会社は、全ての取締役及び監査役が貸借対照表日に退任した場合の支給見込額を取締役及び監査役に対する退職慰労引当金として計上している。なお、当社は、2006年3月31日に終了した事業年度より、取締役及び監査役に対する退職慰労金制度を廃止している。2006年3月31日現在、取締役分については2005年3月31日、監査役分については2005年6月30日時点の支給見込み額を退職慰労引当金として計上している。

(11) 外貨換算

当社及び国内の連結子会社における外貨建資産・負債及び国外の連結子会社の財務諸表は日本の外貨建取引の会計基準に従って、以下のように換算している。

a) 当社及び国内連結子会社における外貨建資産・負債

原則として、貸借対照表日の為替レートで円換算している。また、為替予約契約が特定のヘッジ要件を満たしている場合には、対応する外貨建資産・負債はそれぞれの契約レートで換算されている。

b) 国外連結子会社の財務諸表

国外の連結子会社の資本を除く資産・負債、収益及び費用は貸借対照表日の為替レートで円換算している。資本項目は取得時又は発生時の為替レートで円換算している。為替差額は連結貸借対照表上、少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めて表示している。

(12) 法人税等

繰延税金資産及び負債は、会計上及び税務上の資産・負債の差異に基づいて認識し、当該差異が解消されると見込まれる年度に適用される実効税率及び税法に基づいて計算している。

(13) 一株当たり金額

一株当たり純資産は貸借対照表日における発行済株式総数に基づいている。

一株当たり当期純利益(希薄化前)は、各年度の発行済株式総数の加重平均に基づいて計算している。一株当たり当期純利益(希薄化後)は、各年度の発行済株式総数の加重平均に基づいて、転換社債の転換及びワラントの行使があったものと仮定して計算している。

一株当たり配当金は中間配当金と前年度に対する配当金の合計を表示している。

(14) 固定資産の減損会計

2006年3月31日に終了した事業年度より、当社及び国内の連結子会社は、固定資産の減損に関する新しい会計基準を適用している。この会計基準は、有形及び無形固定資産について、償却後の原価で繰り越され、その資産の繰越価額に回収可能性が無い状況を示す状況や環境の変化がある場合は、減損を認識すべきかを検討することを要求している。資産の減損を示す一定の兆候が存在し、資産の帳簿価額が割引前の将来キャッシュ・フローの総額を上回る場合は、損益計算書において減損損失を認識することが要求されている。当該基準は、減損損失が、(1)処分費用を控除した当該資産の公正なる市場価値と、(2)当該資産の継続的使用と使用後の処分によって生ずる将来キャッシュ・フローの現在価値とのいずれか高いほうの金額を帳簿価格を上回る額で測定されるべきであることを記載している。当該基準は土地、工場、建物やその他の工具器具備品のみならず無形固定資産も対象としている。固定資産は他の資産グループから独立したキャッシュ・フローを認識できる最小単位でのグルーピングが意図されている。

この新しい会計基準が適用された結果、2006年3月31日に終了した事業年度において認識された固定資産の減損損失は無かった。

3 投資有価証券

2005年及び2006年3月31日現在の時価のある有価証券の取得原価及び時価の合計は以下のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2005	2006	2006
取得原価	¥2,591	¥2,836	\$24,145
時価	2,715	5,097	43,390
未実現利益	¥ 124	¥2,260	\$19,244

時価のない有価証券の取得原価の合計は、2005年3月31日現在808百万円、2006年3月31日現在689百万円(5,868千米ドル)である。

4 たな卸資産

2005年及び2006年3月31日現在のたな卸資産は以下のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2005	2006	2006
商品及び製品	¥ 4,390	¥ 3,429	\$ 29,190
仕掛品	21,570	21,429	182,428
材料及び貯蔵品	2,174	2,194	18,685
	¥28,134	¥27,053	\$230,304

5 短期借入金及び長期債務

2005年及び2006年3月31日に終了した各事業年度の短期借入金の年間平均利率はそれぞれ0.69%及び0.64%である。

2005年及び2006年3月31日現在の長期債務は以下のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2005	2006	2006
担保付長期債務			
銀行借入			
2005年3月31日現在、返済期限2005年から2006年、利率1.250%から2.100%、 2006年3月31日現在、返済期限2006年、利率1.370%	¥ 2,699	¥ 750	\$ 6,384
社債			
利率2.300%、償還期限2006年	150	-	-
無担保付長期債務			
銀行借入			
2005年3月31日現在、返済期限2005年から2010年、利率0.880%から1.650%、 2006年3月31日現在、返済期限2006年から2010年、利率0.880%から1.600%	8,214	8,003	68,136
社債			
2005年3月31日現在、償還期限2005年から2007年、利率0.820%から1.230%、 2006年3月31日現在、償還期限2006年から2007年、利率0.910%から1.230%	2,200	1,900	16,174
転換社債			
利率0.850%、償還期限2008年、 利率0.000%、償還期限2008年	51	51	434
	17,500	13,965	118,881
	30,815	24,669	210,010
控除：1年以内に返済期限の到来する額	4,610	3,773	32,122
	¥26,204	¥20,896	\$177,887

2006年3月31日において、全ての未償還の2008年償還期限0.850%転換社債が期末の転換価格(1株につき1,816円60銭(15.5米ドル))で転換された場合、28,074株発行される。全ての未償還の2008年償還期限0.000%転換社債が期末の転換価格(1株につき5,121円60銭(43.6米ドル))で転換された場合、2,726,686株発行される。

2006年3月31日以降の長期債務(流動部分を含む)の年度別返済予定額は以下のとおりである。

3月31日終了年度	百万円	千米ドル
2007年	¥ 3,773	\$ 32,122
2008年	3,568	30,373
2009年	15,857	134,987
2010年	1,462	12,445
2011年以降	9	80
	¥24,669	\$210,010

2006年3月31日現在、短期借入金1,200百万円(10,215千米ドル)及び一年内返済予定長期借入金750百万円(6,384千米ドル)に対して担保提供された資産は、土地378百万円(3,220千米ドル)及び建物3,945百万円(33,585千米ドル)である。

6 退職給付債務

当社は日本の厚生年金保険法に準拠した厚生年金従業員年金基金、非拠出型の税制適格退職年金制度及び退職金制度を採用している。国内子会社は非拠出型の税制適格年金制度及び退職金制度を採用している。

2005年及び2006年3月31日に終了した事業年度の退職給付債務、退職給付費用及び退職給付債務等の計算の基礎の内容は以下のとおりである。

(1) 退職給付債務に関する事項

	百万円		千米ドル
	2005	2006	2006
退職給付債務	¥7,516	¥ 7,409	\$ 63,076
年金資産(退職給付信託を含む)	3,104	5,599	47,664
退職給付引当金	3,610	3,822	32,539
未認識数理計算上の差異	¥ 801	¥(2,012)	\$(17,127)

(2) 退職給付費用に関する事項

	百万円		千米ドル
	2005	2006	2006
勤務費用	¥381	¥382	\$3,253
利息費用	134	132	1,125
期待運用収益	(15)	(14)	(126)
数理計算上の差異の費用処理額	231	169	1,441
期間純退職給付費用	¥731	¥668	\$5,693

(3) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

	2005	2006
割引率	2.00%	2.00%
期待運用収益率	2.50%	2.50%
退職給付費用の配分方法	定額法	定額法
未認識の数理計算上の差異の償却期間	10年	10年

取締役及び監査役に対する退職慰労引当金の合計は、2005年3月31日現在675百万円、2006年3月31日現在353百万円(3,009千米ドル)である。

7 税金

当社及び国内の連結子会社は、その所得に対してさまざまな税金が課されており、2005年及び2006年における法定実効税率は合計でそれぞれおよそ40.69%である。国外の連結子会社の法人税等は、全体として当

該国で適用される税率に基づいている。2005年及び2006年3月31日に終了した事業年度の連結損益計算書の実効税率は本来の実効税率とは異なる。その差異の原因となった主な項目は以下のとおりである。

	2005	2006
法定実効税率	40.69%	40.69%
評価性引当額	35.47	11.59
子会社投資に係る将来減算一時差異に係る税額	(52.19)	—
試験研究費に係る法人税等の特別控除額	(4.77)	—
自己株式処分差益に係る税額	—	1.81
在外連結子会社留保利益税効果額	—	2.30
その他	4.20	1.35
実効税率	23.40%	57.74%

2005年及び2006年3月31日の主要な繰延税金資産及び負債の項目は次のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2005	2006	2006
繰延税金資産:			
子会社投資に係る将来減算一時差異	¥ 3,340	¥ —	\$ —
退職給付引当金	2,465	2,663	22,670
未実現利益	804	557	4,749
繰越欠損金	1,319	2,431	20,701
未払賞与	387	352	2,997
その他	1,090	788	6,708
繰延税金資産 小計	9,408	6,793	57,827
評価性引当額	(1,285)	(1,241)	(10,564)
繰延税金資産	8,123	5,551	47,263
繰延税金負債:			
退職給付信託設定益	(704)	(704)	(5,999)
固定資産圧縮積立金	(101)	(50)	(425)
在外子会社留保利益	(229)	(371)	(3,160)
その他有価証券評価差額金	(49)	(919)	(7,828)
その他	—	(150)	(1,282)
繰延税金負債	(1,084)	(2,196)	(18,697)
繰延税金資産の純額	¥ 7,038	¥ 3,355	\$28,565

8 株主持分

日本の商法(商法)は取締役会の決議により発行された新株発行価額の
内少なくとも50%を資本に組み入れることを要求している。資本金に組
み入れる額を超過した金額を資本準備金として計上している。

取締役会決議により資本準備金を資本に組み入れることができ、また株
主総会決議により配当可能利益に組み入れることができる。

利益剰余金に含まれている利益準備金は商法の規定に従い、利益剰余金
処分により積み立てている。この利益準備金は配当に充てることはできな
いが、株主総会の決議により欠損金の減額または解消に使用することがで
き、また取締役会の決議により資本に組み入れることができる。

配当金は、その該当する会計年度後に開催される株主総会で決議され

る。それに加えて、商法の制限に従い、取締役会決議で中間配当を支払うこ
ともできる。

会計年度の間に留保利益から支払われる配当金は、前会計年度の年度末
の配当金及び当会計年度の間配当である。

商法は、資本準備金の額と合わせて資本金の25%に達するまでは利益
の処分として支出する金額の10%以上を利益準備金として積み立てるこ
とを規定している。また、株主総会決議をもって資本準備金及び利益準備
金の合計額より資本金の25%に相当する額を控除した額を限度として資
本準備金及び利益準備金を減少させることができるとしている。

9 リースに関する情報

2005年及び2006年3月31日において、オペレーションリース取引と
して処理されたファイナンスリース取引を、ファイナンスリース取引

として処理する場合のリース資産の取得原価及び減価償却累計額並び
に帳簿価額は以下のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2005	2006	2006
機械装置:			
取得価額	¥3,534	¥1,348	\$11,481
減価償却累計額	1,095	826	7,038
純帳簿価額	¥2,439	¥ 521	\$ 4,443
その他:			
取得価額	¥ 557	¥ 537	\$ 4,571
減価償却累計額	284	182	1,553
純帳簿価額	¥ 273	¥ 354	\$ 3,018

上記のファイナンスリース取引に関して、2005年及び2006年3月31日に終了した事業年度の支払リース料、各リース期間における残存価額ゼロ
の定額法により計算された減価償却費相当額及び支払利息相当額は次のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2005	2006	2006
支払リース料	¥635	¥730	\$6,215
減価償却費相当額	571	648	5,521
支払利息相当額	76	95	808

オペレーションリース取引として処理しているファイナンスリース取引の将来の支払リース料は次のように要約される。

	百万円		千米ドル
	2005	2006	2006
1年以内	¥ 607	¥315	\$2,689
1年超	2,187	604	5,144
	¥2,795	¥920	\$7,833

10 デリバティブ取引

当社及びその連結子会社が2005年及び2006年3月31日に保有していた全てのデリバティブ取引はヘッジ目的であるため、デリバティブ取引ごとの市場価格の関連情報は記載を要しない。

11 偶発債務

偶発債務は次のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2005	2006	2006
受取手形割引高	¥2,941	¥4,943	\$42,079
輸出為替手形割引高	696	1,270	10,815
非連結子会社である東精精密設備(上海)の銀行借入への保証債務	90	-	-

12 連結損益計算書関係注記

(1) 研究開発費

研究開発費は一般管理費と当期製造費用に含まれており、その金額は次のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2005	2006	2006
一般管理費	¥ 315	¥1,414	\$12,040
当期製造費用	5,984	6,505	55,381

(2) 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2005	2006	2006
販売費			
従業員給与手当	¥1,831	¥2,004	\$17,062
賞与引当金繰入額	120	79	677
退職給付引当金繰入額	98	104	885
販売手数料	2,531	2,318	19,733
貸倒引当金繰入額	17	-	-
一般管理費			
従業員給与手当	571	647	5,515
賞与引当金繰入額	28	19	169
退職給付引当金繰入額	35	37	322
役員退職慰労引当金繰入額	214	18	154
研究開発費	315	1,414	12,040
連結調整勘定償却額	-	171	1,456

13 希薄化前後の一株当たり純利益の差異調整

2005年及び2006年3月31日に終了した事業年度における基本的な一株当たり純利益と潜在株式調整後の差異は次のとおりである。

	百万円	千株	円	米ドル
	当期純利益	加重平均株式数	一株当たり純利益	
2006年3月31日に終了した事業年度				
希薄化前 一株当たり純利益				
普通株式に係る純利益	¥3,110	38,515	¥ 80.77	\$0.68
希薄化株式の影響				
新株予約権	-	186		
転換社債	0	3,328		
希薄化後 一株当たり純利益	¥3,111	42,029	¥ 74.02	\$0.63
2005年3月31日に終了した事業年度				
希薄化前 一株当たり純利益				
普通株式に係る純利益	¥4,449	37,452	¥118.82	
希薄化株式の影響				
新株予約権	-	13		
転換社債	0	3,453		
希薄化後 一株当たり純利益	¥4,450	40,920	¥108.75	

14 連結キャッシュ・フロー計算書関係注記

2005年及び2006年3月31日に終了した事業年度における、貸借対照表とキャッシュ・フロー計算書との現金及び現金同等物の調整は次のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2005	2006	2006
現金及び現金同等物(貸借対照表)	¥11,866	¥13,887	\$118,218
マネー リザーブ ファンド	-	2	19
預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金	(28)	(38)	(323)
現金及び現金同等物(キャッシュ・フロー計算書)	¥11,838	¥13,851	\$117,914

重要な非資金取引:

(1) 当社は2005年10月に株式交換を行い、(株)東精エンジニアリングを完全子会社とした。株式交換の結果、資本準備金が6,218百万円増加している。

(2) 2005年及び2006年3月31日に終了した事業年度における、転換社債の転換の内容は次のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2005	2006	2006
転換社債の転換による資本金の増加	¥-	¥1,767	\$15,047
転換社債の転換による資本準備金の増加	-	1,767	15,045
転換社債の減少	¥-	¥3,534	\$30,092

15 セグメント情報

当社及び連結子会社は主として2つの事業セグメントにおいて製品の製造・販売を行っている。

1) 半導体製造装置: ウェーハブローピングマシン、ウェーハダイシングマシン、ウェーハ外観検査装置、CMP装置、ポリッシュ・グラインダ、

リソグラフィ装置、ウェーハ製造装置等

2) 計測機器: 三次元座標測定機、表面粗さ・輪郭形状測定機、真円度測定機、マシンコントロールゲージ等

当社及び連結子会社の2005年及び2006年3月31日に終了した事業年度の事業別セグメント、所在地別セグメント及び海外売上高の概要は以下のとおりである。

(a) 事業別セグメント

2005年3月31日に終了した事業年度	百万円				
	半導体製造装置	計測機器	合計	消去又は全社	連結
売上高及び営業収益					
外部売上高	¥66,669	¥18,081	¥84,750	¥ -	¥ 84,750
セグメント間の売上高及び振替高	-	-	-	-	-
売上高合計	66,669	18,081	84,750	-	84,750
営業費用	57,884	13,814	71,698	-	71,698
営業利益	¥ 8,784	¥ 4,267	¥13,051	¥ -	¥ 13,051
資産、減価償却費及び資本的支出					
資産	¥80,434	¥18,947	¥99,382	¥ 1,611	¥100,993
減価償却費	2,404	327	2,732	-	2,732
資本的支出	2,731	1,040	3,771	-	3,771

2006年3月31日に終了した事業年度	百万円				
	半導体製造装置	計測機器	合計	消去又は全社	連結
売上高及び営業収益					
外部売上高	¥71,824	¥21,020	¥ 92,845	¥ -	¥ 92,845
セグメント間の売上高及び振替高	-	-	-	-	-
売上高合計	71,824	21,020	92,845	-	92,845
営業費用	62,852	16,000	78,853	-	78,853
営業利益	¥ 8,972	¥ 5,019	¥ 13,991	¥ -	¥ 13,991
資産、減価償却費及び資本的支出					
資産	¥83,885	¥21,256	¥105,141	¥4,733	¥109,875
減価償却費	2,337	430	2,768	-	2,768
資本的支出	3,399	578	3,978	-	3,978

千米ドル

2006年3月31日に終了した事業年度	半導体製造装置	計測機器	合計	消去又は全社	連結
売上高及び営業収益					
外部売上高	\$611,432	\$178,941	\$790,373	\$ -	\$790,373
セグメント間の売上高及び振替高	-	-	-	-	-
売上高合計	611,432	178,941	790,373	-	790,373
営業費用	535,051	136,212	671,263	-	671,263
営業利益	\$ 76,380	\$ 42,729	\$119,109	\$ -	\$119,109
資産、減価償却費及び資本的支出					
資産	\$714,100	\$180,950	\$895,050	\$40,299	\$935,350
減価償却費	19,902	3,664	23,567	-	23,567
資本的支出	28,942	4,924	33,867	-	33,867

(b)所在地別セグメント

2005年3月31日に終了した事業年度	日本	米国	ドイツ	地域合計	消去又は全社	連結
売上高及び営業収益						
外部売上高	¥69,846	¥9,226	¥5,677	¥ 84,750	¥ -	¥ 84,750
セグメント間の売上高及び振替高	9,277	-	-	9,277	(9,277)	-
売上高合計	79,123	9,226	5,677	94,027	(9,277)	84,750
営業費用	66,386	9,199	5,478	81,064	(9,365)	71,698
営業利益	¥12,737	¥ 27	¥ 199	¥ 12,963	¥ 88	¥ 13,051
資産	¥96,292	¥6,052	¥2,363	¥104,708	¥(3,715)	¥100,993

2006年3月31日に終了した事業年度	日本	米国	ドイツ	地域合計	消去又は全社	連結
売上高及び営業収益						
外部売上高	¥ 78,130	¥9,054	¥5,660	¥ 92,845	¥ -	¥ 92,845
セグメント間の売上高及び振替高	9,409	-	-	9,409	(9,409)	-
売上高合計	87,539	9,054	5,660	102,254	(9,409)	92,845
営業費用	74,322	8,809	5,137	88,269	(9,415)	78,853
営業利益	¥ 13,217	¥ 244	¥ 523	¥ 13,985	¥ 6	¥ 13,991
資産	¥101,349	¥6,468	¥2,940	¥110,758	¥ (882)	¥109,875

2006年3月31日に終了した事業年度						千米ドル
	日本	米国	ドイツ	地域合計	消去又は全社	連結
売上高及び営業収益						
外部売上高	\$665,112	\$77,076	\$48,184	\$790,373	\$ -	\$790,373
セグメント間の売上高及び振替高	80,098	-	-	80,098	(80,098)	-
売上高合計	745,210	77,076	48,184	870,472	(80,098)	790,373
営業費用	632,694	74,993	43,732	751,419	(80,156)	671,263
営業利益	\$112,516	\$ 2,082	\$ 4,452	\$119,052	\$ 57	\$119,109
資産	\$862,765	\$55,067	\$25,030	\$942,863	\$(7,513)	\$935,350

(c) 海外売上高

当社及び国内連結子会社の海外売上高及び海外連結子会社の売上高を含む海外売上高は次のとおりである。

2005年3月31日に終了した事業年度					百万円
	東アジア	北米	ヨーロッパ	その他	連結
海外売上高	¥25,048	¥8,166	¥5,706	¥3,938	¥42,860
連結売上高					84,750
連結売上高に占める海外売上高の割合	29.6%	9.6%	6.7%	4.7%	50.6%

2006年3月31日に終了した事業年度					百万円
	東アジア	北米	ヨーロッパ	その他	連結
海外売上高	¥31,224	¥7,043	¥5,034	¥4,374	¥47,676
連結売上高					92,845
連結売上高に占める海外売上高の割合	33.6%	7.6%	5.4%	4.7%	51.3%

2006年3月31日に終了した事業年度					千米ドル
	東アジア	北米	ヨーロッパ	その他	連結
海外売上高	\$265,808	\$59,958	\$42,857	\$37,238	\$405,863
連結売上高					790,373
連結売上高に占める海外売上高の割合	33.6%	7.6%	5.4%	4.7%	51.3%

16 後発事象

以下の当社の剰余金の処分は2006年6月29日開催の株主総会で承認された。なお、当該剰余金処分は添付した2006年3月31日に終了した事業年度の連結財務諸表には反映されていない。

	百万円	千米ドル
事業年度末配当金(1株当たり20円=0.17米ドル)	¥801	\$6,822

独立監査人の監査報告書



株式会社東京精密 取締役会 御中

当監査法人は、添付されている株式会社東京精密及び連結子会社の日本円で表示された2005年及び2006年3月31日現在の連結貸借対照表並びに関連する同日をもって終了する各事業年度の連結損益計算書、連結株主持分計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書の監査を行った。これらの財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場からそれらの財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、日本において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、日本において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社東京精密及び連結子会社の2005年及び2006年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する各事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

2006年3月31日をもって終了する事業年度に関して添付されている連結財務諸表における米ドル額は、便宜上表示したにすぎない。当監査法人の監査は、日本円貨額から米ドル額への換算も含んでいる。この換算方法は連結財務諸表注記1の記載に基づいている。

新日本監査法人

Ernst & Young ShinNihon

2006年6月29日

ネットワーク

日本

株式会社東京精密

本社

〒181-8515
東京都三鷹市下連雀9-7-1
Tel: (0422) 48-1011
Fax: (0422) 48-1204

八王子工場

〒192-0032
東京都八王子市石川町2968-2
Tel: (0426) 42-0381
Fax: (0426) 42-0386

土浦工場

〒300-0006
茨城県土浦市東中貫町4
Tel: (029) 831-1234
Fax: (029) 831-4453

株式会社東精エンジニアリング

本社

〒300-0006
茨城県土浦市東中貫町4-6
Tel: (029) 830-1888
Fax: (029) 830-1881

株式会社アクレーテック・マイクロテクノロジー

本社

〒192-0032
東京都八王子市石川町2968-2
Tel: (0426) 60-5225
Fax: (0426) 60-5226

株式会社トーエーシステムズ

本社

〒192-0032
東京都八王子市石川町2968-2
Tel: (0426) 45-1911
Fax: (0426) 45-1942

株式会社アクレーテック・クリエイト

本社

〒181-8515
東京都三鷹市下連雀9-7-1
Tel: (0422) 48-1011
Fax: (0422) 49-7068

株式会社アクレーテック・ファイナンス

本社

〒181-8515
東京都三鷹市下連雀9-7-1
Tel: (0422) 48-1011
Fax: (0422) 42-3816

株式会社東精ボックス

本社

〒192-0032
東京都八王子市石川町2968-2
Tel: (0426) 60-0845
Fax: (0426) 60-0965

北米

米国

Accretech USA, Inc.

Corporate Head Office
2600 Telegraph Rd., Suite 180,
Bloomfield Hills, MI 48302,
U.S.A.
Tel: 1 (248) 332-0100
Fax: 1 (248) 332-0700

SEMICONDUCTOR EQUIPMENT SECTOR (SES)

Austin Office
3500 Wadley Place, Building A,
Austin, TX 78728, U.S.A.
Tel: 1 (512) 246-4500
Fax: 1 (512) 246-4501

Milpitas Office
1765 S. Main Street, Suite 121,
Milpitas, CA 95035, U.S.A.
Tel: 1 (408) 719-2400
Fax: 1 (408) 719-2401

Dallas Office
3400 Waterview Parkway, Suite
109, Richardson, TX 75080 U.S.A.
Tel: 1 (972) 735-0880
Fax: 1 (972) 735-0890

Boise Office
800 E. Citation Court, Suite A,
Boise, ID 83716, U.S.A.
Tel: 1 (208) 429-6500
Fax: 1 (208) 429-6555

WAFER MANUFACTURING SECTOR (WMS)

Austin Office
3500 Wadley Place, Building A,
Austin, TX 78728, U.S.A.
Tel: 1 (512) 246-4500
Fax: 1 (512) 246-4501

METROLOGY EQUIPMENT SECTOR (MES)

Detroit Office
37735 Enterprise Court, Suite 400,
Farmington Hills,
MI 48331, U.S.A.
Tel: 1 (248) 489-5500
Fax: 1 (248) 489-5503

ヨーロッパ

Accretech (Europe) GmbH

ドイツ

Head Office
Landsberger Str. 396,
D-81241 Munich, Germany
Tel: 49 (89) 546788-0
Fax: 49 (89) 546788-10

Dresden Office
Zur Wetterwarte 10,
Geb. 104, EG,
D-01109 Dresden, Germany
Tel: 49 (351) 89024-11
Fax: 49 (351) 89024-12

フランス

French Office

Le Square A17, Suroit,
48 Avenue du Lac du Bourget,
BP275, 73375 Le Bourget
du Lac Cedex, France
Tel: 33 (479) 26-1541
Fax: 33 (479) 26-1549

イタリア

Milan Office

Via Roggia Renatella 2/A,
Cernusco s/N, I-20063 Milan,
Italy
Tel: 39 (2) 92112357
Fax: 39 (2) 92111477

アジア

中国

Accretech (China) Co., Ltd.

Head Office
Room 12B05, Marine Tower,
1 Pudong Ave, Shanghai 200120,
China
Tel: 86 (21) 3887-0801
Fax: 86 (21) 3887-0805

Beijing Office
11E# Office Building, No. 48, Dong
Zhi Men Wai, Dong Cheng District,
Beijing 100027, China
Tel: 86 (10) 8447-7011
Fax: 86 (10) 8447-7010

Shenzhen Office
Room 2409, Golden Business Cen-
ter, No. 2028 Shennan Road East,
Shenzhen, Guangdong Province
518001, China
Tel: 86 (755) 2515-9842
Fax: 86 (755) 2515-7737

Guangzhou Office
Room 1907, East Tower, Yang
Cheng
International Commercial Center,
122
Ti Yu Dong Road, Tian He District,
Guang Zhou, Guangdong Province,
China, 510620
Tel: 86 (20) 3887-0975
Fax: 86 (20) 3887-0627

Chongqing Office
21-FA3, Chongqing
Lanko Hyatt Building,
2 Nanping West Road,
Nanan District, Chongqing 400060,
China
Tel: 86 (23) 6295-5061
Fax: 86 (23) 6295-5060

TOSEI MEASURING (PINGHU) CO., LTD.

No. 666, Xingping Second Road,
Economic Development Zone,
Pinghu, Zhejiang 314200, China
Tel: 86 (573) 509-0102
Fax: 86 (573) 509-0304

Sanmenxia Zhongyuan

Tokyo Seimitsu Co., Ltd.

9 Western End of Heping Road,
Sanmenxia, Henan 472000,
China
Tel: 86 (398) 285-4108
86 (398) 285-4208
Fax: 86 (398) 282-1510
86 (398) 285-4208

韓国

TOSEI KOREA Co., Ltd.

B-511, Lion's Valley 371-28,
Gasan-Dong Geumcheon-Gu,
Seoul, 153-786, Korea
Tel: 82 (2) 2026-5543
Fax: 82 (2) 2026-5543

Accretech Micro Technologies

Korea Co., Ltd.

R304, Cheong-yong Bld, 696-1
Komae-Ri, Kiheung-Eup, Yongin-Si,
Kyungki-Do, Korea
Tel: 82 (31) 287-3016
Fax: 82 (31) 287-3019

台湾

Tokyo Seimitsu Co., Ltd.

Accretech Technical Center Taiwan

5F-1, No. 69, Tze You Road,
Hsinchu, Taiwan
Tel: 886 (3) 531-6633
Fax: 886 (3) 531-3722

マレーシア

Accretech (Malaysia) Sdn. Bhd.

Head Office
39 Jalan PJS 11/2,
46000 Subang Indah,
Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: 60 (3) 5632-7488
Fax: 60 (3) 5632-7489

Penang Office
E-PARK Block 2A-7-5,
Jalan Batu Uban,
11700 Penang, Malaysia
Tel: 60 (4) 656-1614
Fax: 60 (4) 656-1614

シンガポール

Accretech (Singapore) Pte. Ltd.

10 Ubi, Crescent #05-
92/93/94/95 Lobby E,
Ubi Techpark 408564, Singapore
Tel: 65 (6741) 1712
Fax: 65 (6382) 1123

タイ

Tosei (Thailand) Co., Ltd.

40/14 Moo 12, Bangna Towers C,
16th Floor Bangna-Trad Road,
K.M. 6.5, Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn 10540, Thailand
Tel: 66 (0) 2751-9563
Fax: 66 (0) 2751-9564

(2006年7月現在)

インベスターインフォメーション

本社所在地:

〒181-8515 東京都三鷹市下連雀9-7-1
Tel: (0422)48-1011
Fax: (0422)48-1204

設立:

1949年3月28日

資本金:

9,447百万円

従業員数:

連結: 1,169名
個別: 644名

株式:

授權資本: 110,501,100株
発行済株式: 40,100,167株(うち、自己株式数26,421株)

総株主数:

18,444名

上場証券取引所:

東京証券取引所 市場第一部(証券コード 7729)

大株主:

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)
野村信託銀行株式会社(投信口)
財団法人精密測定技術振興財団
株式会社みずほコーポレート銀行
三井生命保険株式会社

株主名簿管理人:

みずほ信託銀行株式会社
〒103-8670 東京都中央区八重洲1-2-1

定時株主総会:

毎年6月中 基準日3月31日

独立監査人:

新日本監査法人

お問い合わせ先:

業務会社 IR室
Tel: (0422)48-1011
Fax: (0422)45-3636
E-mail: ir@accrettech.jp

(2006年3月31日現在)



株式会社東京精密

〒181-8515 東京都三鷹市下連雀9-7-1

Tel: (0422) 48-1011

Fax: (0422) 48-1204

<http://www.accretech.jp>



このアニュアルレポートは再生紙を使用しております。
Printed in Japan